

证券代码：300726

证券简称：宏达电子



株洲宏达电子股份有限公司

(住所：湖南省株洲市荷塘区新华东路 1297 号)

2021 年度向特定对象发行 A 股股票

募集说明书

(注册稿)

保荐机构（主承销商）



中国国际金融股份有限公司

(北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

二〇二一年九月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本募集说明书是公司对本次发行的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。

4、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审核与注册。

重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项或风险因素给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书相关章节。

一、本次向特定对象发行 A 股股票情况

1、本次发行相关事项已经2021年6月4日召开的本公司第二届董事会第二十次会议、2021年6月23日召开的本公司2021年度第一次临时股东大会审议通过，并已通过深交所审核。根据《公司法》、《证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行尚需经中国证监会同意注册后方可实施。在中国证监会同意注册后，公司将向深交所和登记结算公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行全部呈报批准程序。

2、本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括境内注册的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。

3、本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息

事项，发行价格将作相应调整。本次发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定及本次发行方案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

4、本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的10%，即不超过4,001.00万股（含本数）。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、分配股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权激励行权等导致股本变化的事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

5、本次向特定对象发行A股股票的发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

6、本次发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资金额	募集资金投入金额
1	微波电子元器件生产基地建设项目	宏达电子	64,700.00	62,000.00
2	研发中心建设项目	成都宏电	20,400.00	18,000.00
3	补充流动资金	宏达电子	20,000.00	20,000.00
合计			105,100.00	100,000.00

若本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额,募集资金不足部分由公司自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前,公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

7、本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后公司新老股东共同享有。

8、本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。

9、本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。本次发行完成后,公司的股权分布符合深交所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

10、为进一步完善和健全公司的利润分配政策,增强利润分配的透明度,保证投资者分享公司的发展成果,引导投资者形成稳定的回报预期,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定,结合公司实际情况,公司制订了《未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》,已经公司第二届董事会第二十次会议和2021年度第一次临时股东大会审议通过。

11、本次发行后,公司的每股收益短期内存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险,虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施,且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺,但所制定的填补回报措施和相关主体作出的承诺不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广大投资者注意。

二、公司相关风险

(一) 应收账款及应收票据回收风险

报告期各期末,公司的应收账款分别为 40,200.00 万元、52,048.17 万元、65,881.80 万元和 104,537.80 万元,占总资产的比例分别为 23.94%、26.37%、22.24%和 30.74%,应收账款坏账准备计提比例分别为 7.79%、7.56%、6.87%、5.33%。

公司的应收票据分别为 37,936.74 万元、46,520.62 万元、76,999.63 万元和 53,949.61 万元，占总资产的比例分别为 22.59%、23.57%、25.99%和 15.86%，应收票据坏账准备计提比例在报告期各期均为 4.00%。报告期内，随着公司营业收入的不断增加，应收账款和应收票据规模也不断增长，主要系公司主要客户为大型高可靠集团下属单位，付款周期相对较长所致，大额应收账款和应收票据影响公司资金回笼速度，给公司带来的资金压力不断提升。如果国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而不能按期付款，将会导致公司出现应收账款及应收票据无法收回的风险。

(二) 存货规模增长及存货减值的风险

报告期内，公司业务规模持续增长，导致存货增长较快。公司的存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品组成。报告期各期末，公司的存货账面价值分别为26,048.82万元、34,815.63万元、57,318.58万元和74,214.46万元，占流动资产比例分别为18.40%、20.71%、24.60%和27.94%。公司存货规模较大，一定程度上占用了公司资金而影响流动性。较高的存货规模仍可能导致计提较大金额的存货跌价准备，进而影响公司的利润水平。报告期各期末，公司分别计提存货跌价准备2,243.61万元、3,475.38万元、4,266.28万元及4,951.05万元。库存量能够保障生产经营的稳定性，但如果原材料、库存商品的行情出现大幅下滑或者公司产品销售不畅、发出商品未能得客户及时验收，而公司未能及时有效应对并做出相应调整，公司将面临存货减值的风险，进而会给公司经营造成一定的不利影响。

(三) 募投项目相关风险

发行人本次募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后将用于微波电子元器件生产基地建设、研发中心建设、补充流动资金三个项目。结合宏观政策、市场环境、下游客户需求、技术更迭、公司经营管理等多方面因素，本次募集资金投资项目风险主要集中在：

1、截至本募集说明书签署日，发行人“微波电子元器件生产基地建设项目”的建设地尚未办理不动产权证过户并取得相关产权证书。如果发行人一直未能取得产权证书，可能对募投项目实施的整体进度造成一定影响。此外，随着公司相关产品产能的扩张，公司的资产规模及业务复杂度将进一步提升，研发、运营和

管理人员将相应增加,如果公司未能根据业务发展状况及时提升人力资源、法律、财务等方面的管理能力,可能会影响项目研发及建设进程,导致项目未能按期投入运营的风险。

2、在募投项目的实施过程中,公司面临行业发展变化、市场竞争变化、高可靠单位验证周期变化等多重不确定性,可能对实现预期收益的前提条件产生不利影响。此外,如本次募投项目的成本费用无法有效控制,或者公司未能按既定计划完成募投项目,可能会影响募投项目的投资成本、投资回收期、投资收益率等,从而可能导致募集资金投资项目的实际效益与预期存在一定的差异。

3、本次募投项目之微波电子元器件生产基地建设项目将新增陶瓷电容器产能200,000万只/年,新增环行器及隔离器产能150万只/年,新增产能均可用于高可靠产品和民用产品。在高可靠领域,发行人已与众多高可靠领域集团签订正式协议;但在民用领域,发行人现有或潜在客户的需求量较大,但受限于产能不足,尚无法满足相关民用客户的大批量需求,因而尚未签署正式业务协议。如果未来民用产品市场拓展不及预期,可能导致募集资金投资项目投产后新增产能无法及时消化,从而对公司经营业绩产生不利影响。

4、发行人按照当前执行的折旧与摊销政策,对本次募投项目新增固定资产进行折旧和摊销。微波电子元器件生产基地建设项目预计建成后的年均折旧和摊销金额为7,925.89万元,研发中心建设项目预计建成后的年均折旧和摊销金额为1,829.16万元,占公司2020年营业收入的比例为6.96%,占本次募投项目预计年新增收入的比例为19.27%,因此可能存在因资产折旧增加导致公司经营业绩受到不利影响的风险。

5、由于下游行业的技术快速更迭,使得公司需不断更新和适应新技术的发展,准确把握市场和客户需求变化,适时布局新产品,不断研发新工艺。本次募投项目之研发中心建设项目实施后,公司每年研发投入支出将存在一定幅度的提升,将对当期业绩产生影响。6、本次募投项目建设的超宽带嵌入式板卡相关产品技术壁垒相对较高、研发难度较大,需要一定的技术和研发人才储备。如果公司出现人才流失,或者无法突破研发难点的情形,则可能导致研发失败,将会对公司的经营情况产生一定的不利影响。

目 录

公司声明	2
重大事项提示	3
一、本次向特定对象发行 A 股股票情况	3
二、公司相关风险	5
目 录	8
释 义	10
第一节 发行人基本情况	14
一、发行人基本信息	14
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况	15
三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况	16
四、发行人主要业务模式、产品的主要内容	22
五、现有业务发展安排及未来发展战略	39
六、财务性投资情况	41
七、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况	42
第二节 本次证券发行概要	44
一、本次发行的背景和目的	44
二、发行对象及与发行人的关系	48
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期	48
四、募集资金投向	50
五、本次发行是否构成关联交易	50
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化	51
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	51
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	52
一、本次发行募集资金使用计划	52
二、本次发行募集资金投资项目的的基本情况	52
三、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的关系	65
四、募集资金投资项目可行性分析结论	66
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	67
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划	67
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化	67
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的	

业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.....	67
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况.....	67
第五节 历次募集资金的使用情况.....	69
一、前次募集资金基本情况.....	69
二、前次募集资金使用情况.....	69
三、前次募集资金使用变更及信息披露情况.....	71
四、前次募集资金投资项目效益情况.....	73
五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况.....	74
六、前次募集资金结余及募集资金后续使用情况.....	74
第六节 与本次发行相关的风险因素.....	76
一、本次向特定对象发行 A 股股票的相关风险.....	76
二、行业及市场风险.....	76
三、业务经营风险.....	77
四、税收及财务风险.....	79
五、募投项目相关风险.....	80
六、股价波动风险.....	82
第七节 与本次发行相关的声明.....	83
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	83
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	84
三、保荐人（主承销商）声明.....	87
四、发行人律师声明.....	90
五、发行人会计师声明.....	91
六、发行人董事会声明.....	92

释 义

在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

一、普通术语		
宏达电子/公司/发行人/上市公司	指	株洲宏达电子股份有限公司
本次向特定对象发行 A 股股票/本次发行	指	宏达电子 2021 年度向特定对象发行不超过 4,001 万股 A 股股票且募集资金总额不超过 100,000 万元的行为
本募集说明书	指	株洲宏达电子股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）
定价基准日	指	发行期首日
《公司章程》	指	《株洲宏达电子股份有限公司章程》
股东大会	指	株洲宏达电子股份有限公司股东大会
董事会	指	株洲宏达电子股份有限公司董事会
监事会	指	株洲宏达电子股份有限公司监事会
控股股东、实际控制人	指	曾琛、钟若农和曾继疆
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国防科工局	指	国家国防科技工业局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法（2018 修正）》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法（2019 修订）》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法（2020 修正）》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行注册管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
湘怡中元	指	湖南湘怡中元科技有限公司
湖南冠陶	指	湖南冠陶电子科技有限公司，原名株洲宏达陶电科技有限公司
湖南宏微	指	湖南宏微电子科技有限公司，原名株洲宏达微电子科技有限公司
宏达磁电	指	株洲宏达磁电科技有限公司
宏达电通	指	株洲宏达电通科技有限公司

宏达膜电	指	株洲宏达膜电有限公司
宏达恒芯	指	株洲宏达恒芯电子有限公司
天微技术	指	株洲天微技术有限公司，原名为株洲宏达天成微波有限公司
华毅微波	指	株洲华毅微波技术科技有限公司
展芯半导体	指	株洲展芯半导体技术有限公司
成都华镭	指	成都华镭科技有限公司
成都宏电	指	成都宏电科技有限公司
宏达惯性	指	株洲宏达惯性科技有限公司
深圳波而特	指	深圳波而特电子科技有限公司
湘鸿电子	指	株洲湘鸿电子设备有限公司
思微特科技	指	湖南思微特科技有限公司
湘君电子	指	湖南湘君电子科技有限公司
湘宏圆网版	指	株洲湘宏圆网版科技有限公司
宏磁电子	指	湖南宏磁电子科技有限公司
容电电子	指	湖南容电电子科技有限公司
卓芯科技	指	成都卓芯科技有限公司
菲尔诺电子	指	湖南菲尔诺电子科技有限公司
株洲特焊	指	株洲特种电焊条有限公司
株洲宏瑞	指	株洲宏瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）
株洲宏明	指	株洲宏明股权投资管理合伙企业（有限合伙）
天津宏湘	指	天津宏湘资产管理合伙企业（有限合伙）
天津宏津	指	天津宏津资产管理合伙企业（有限合伙）
株洲县融兴村镇银行	指	株洲县融兴村镇银行有限责任公司
宏讯微电子	指	成都宏讯微电子科技有限公司
芯瓷电子	指	株洲市芯瓷电子陶瓷有限公司
君民电子	指	湖南君民电子科技有限公司
宁夏艾森达	指	宁夏艾森达新材料科技有限公司
银川艾森达	指	银川艾森达新材料发展有限公司
湘东化工	指	湖南湘东化工机械有限公司
报告期内/最近三年及一期	指	2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月
报告期各期末	指	2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日
A 股	指	在深圳证券交易所上市的每股面值为人民币1.00元的普通股

元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
二、专业术语		
电子元器件	指	对各种电子元件和电子器件的总称。其中工厂在加工时没改变原材料分子成分的产品可称为元件，元件属于不需要能源的器件，包括电阻、电容、电感等。器件是指工厂在生产加工时改变了原材料分子结构的产品，包括双极性晶体三极管、场效应晶体管、可控硅、半导体电阻电容等
电容	指	电容器，是一种容纳电荷的元件。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一，广泛应用于电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等方面
电阻	指	电阻器，是一种限流元件，将电阻接在电路中后，可限制通过它所连支路的电流大小
电感	指	电感器，是一种能够把电能转化为磁能而存储起来的元件，在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用
钽电容器	指	钽电解电容器，为使用钽氧化膜为电介质的电容器，具有适宜贮存、寿命长、单位体积容量大、漏电流极小、受温度影响小、高频特性好、可靠性高等特点
陶瓷电容器	指	介质材料为陶瓷的电容器，包括多层瓷介电容器（MLCC）和单层片式瓷介电容器（SLC）
铝电容器	指	介质材料为铝氧化物的电容器，由电极箔、电解液、电解电容器纸等材料组成
薄膜电容器	指	以有机薄膜为介质材料的电容器，以金属箔当电极，将其和聚乙酯、聚丙烯、聚苯乙烯或聚碳酸酯等有机塑料薄膜，从两端重叠后卷绕成圆筒状的电容器
MLCC	指	多层瓷介电容器，业界常指片式多层瓷介电容器，标准上称多层片式瓷介电容器。是由印好电极（内电极）的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来，经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片，再在芯片的两端封上金属层（外电极），形成一个类似独石的结构体，也被称为独石电容器
高能钽混合电容器	指	钽外壳封装非固体电解质钽电容器，主要指THC系列钽电容器
微波组件	指	利用各种微波元器件（至少有一个是有源的）和其他零件组装而成的产品
SLC	指	单层片式瓷介电容器，是由无机陶瓷体和正反面纯金电极组成的，其特点是结构简单，陶瓷强度高，电性能稳定可靠
5G	指	第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，是4G之后的延伸
芯片	指	又称微电路、微芯片、集成电路，是内含集成电路的

		硅片，体积小，常常是计算机或其他电子设备的一部分
I/F转换器	指	电流频率转换电路或电流频率转换器，其主要作用是将被测电流信号转换为数字信号，处理器只需对该数字信号进行计数即可得到被测电流的大小
温度传感器	指	是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器
增强型移动宽带	指	具备更大的吞吐量、低延时以及更一致的体验移动宽带
大规模机器类通信	指	物联网的应用场景，主要关注人与物之间的信息交互
低时延高可靠通信	指	物联网的应用场景，主要体现物与物之间的通信需求
大规模天线技术	指	天线通道数量多、信号覆盖维度广的天线技术

本募集说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司中文名称：株洲宏达电子股份有限公司

公司英文名称：Zhuzhou Hongda Electronics Corp.,Ltd.

法定代表人：钟若农

注册资本：40,010.00 万元

总股本：40,010 万股

成立日期：1993 年 11 月 18 日（2015 年 11 月 27 日整体变更为股份有限公司）

注册地址：湖南省株洲市荷塘区新华东路 1297 号

办公地址：湖南省株洲市天元区渌江路 2 号

邮政编码：412000

董事会秘书：曾垒

联系方式：0731-22397170

传真号码：0731-22397170

公司网址：www.zzhddz.com

公司股票上市地：深圳证券交易所

证券简称：宏达电子

宏达电子证券代码：300726

统一社会信用代码：91430200616610317F

经营范围：电阻电容电感及其他元件、滤波器、变压器、磁珠、微波铁氧体磁性器件、微波功率器件、电子电路、微电路模块、IF 模块、VF 模块、微波组

件、集成电路、电源管理芯片、电子专用材料研发、制造、销售及服务；计算机硬件、支撑软件开发、制造、销售及服务；电子仪器、电气设备开发、生产、销售及服务；电子产品检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）前十名股东情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数（股）	持股比例（%）
1	曾琛	140,800,000	35.19
2	钟若农	122,401,896	30.59
3	曾继疆	24,798,104	6.20
4	中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	4,937,459	1.23
5	香港中央结算有限公司	3,891,195	0.97
6	天津宏湘	3,876,800	0.97
7	陈寅元	3,559,083	0.89
9	株洲宏明	2,523,999	0.63
10	交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金	1,892,750	0.47
合计		311,676,665	77.90

注：1、上述股东中，钟若农和曾继疆为夫妻关系，曾琛为其二人之女，三人为一致行动人；

2、2021年7月9日，曾继疆减持2,000,000股公司股份，截至本募集说明书签署日，曾继疆持有公司22,798,104股股份，持股比例为5.70%；除上述情况外，2021年6月30日至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人曾琛、钟若农、曾继疆持有公司股份情况未发生变动。

（二）控股股东情况

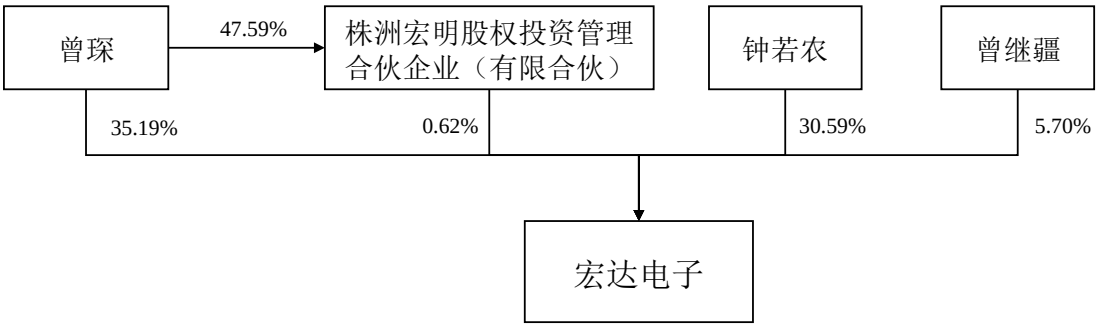
截至本募集说明书签署日，公司总股本为 400,100,000 股，曾琛直接持有公司 140,800,000 股股份，占总股本的 35.19%；钟若农直接持有公司 122,401,896 股股份，占总股本的 30.59%；曾继疆直接持有公司 22,798,104 股股份，占总股本的 5.70%。三人为一致行动人，合计直接持有公司总股本的 71.48%，为公司的控股股东。

（三）实际控制人

截至本募集说明书签署日，曾琛直接持有公司 35.19%的股份；钟若农直接持有公司 30.59%的股份；曾继疆直接持有公司 5.70%的股份。三人为一致行动人，合计直接持有公司 71.48%的股份，为公司的实际控制人。

（四）股权结构

截至本募集说明书签署日，公司与实际控制人的具体股权控制结构如下图所示：



三、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况

（一）行业管理体制及政策法规

1、所属行业

公司主要业务为高可靠电子元器件和电路模块的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）；根据《国民经济行业分类》（2017 年），公司所处行业为电阻电容电感元件制造业（分类代码：C3981）。

2、行业管理部门及管理体制

电子元器件行业的主管部门主要为发改委和工信部，其主要负责产业政策的制定，提出高新技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目，指导行业发展。

公司所属行业协会为中国电子元件协会（CECA），该协会是中国电子元件行业的自律组织，协会下设电阻电位器分会、电容器分会、电子陶瓷及器件分会、压电晶体分会和光电线缆及光器件分会等 15 个分会。中国电子元件行业协会主要职能是开展行业调查研究和经营活动数据统计分析，加强行业自律，维护市场

竞争环境，组织新产品鉴定、科研成果评审、行业标准制订和质量监督等工作。该行业协会通过为会员单位服务，维护会员单位和行业的合法权益，推进电子元件行业的改革和发展，加速电子元件行业的现代化建设，并通过民主协商、协调，为行业的共同利益，发挥提供服务、反映诉求、规范行为的作用。

3、行业主要法律法规及相关政策

(1) 行业主要法律法规

序号	法律法规	颁布部门	颁布/修订时间	相关内容
1	《中华人民共和国安全生产法》	全国人大	2014 年	对生产经营单位的安全生产保障，从业人员的安全生产权利与义务，安全生产监管管理，生产安全的应急救援进行规定。
2	《中华人民共和国环境保护法》	全国人大	2014 年	主要为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康。
3	《中华人民共和国国家安全法》	全国人大	2015 年	对维护国家安全的任务与职责，国家安全制度，国家安全保障，公民、组织的义务和权利等方面进行了规定。
4	《中华人民共和国标准化法》	全国人大	2017 年	加强标准化工作，提升产品和服务质量，促进科学技术进步，保障人身健康和生命财产安全，维护国家安全、生态环境安全。
5	《中华人民共和国产品质量法》	全国人大	2018 年	加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益。

(2) 行业相关政策

序号	政策名称	颁布部门	颁布时间	相关内容
1	《中国制造 2025》(国发〔2015〕28 号)	国务院	2015 年	核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（以下统称“四基”）等工业基础能力薄弱，是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。统筹推进“四基”发展。制定工业强基实施方案，明确重点方向、主要目标和实施路径。加强“四基”创新能力建设。强化前瞻性基础研究，着力解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术。推动整机企业和“四基”

序号	政策名称	颁布部门	颁布时间	相关内容
				企业协同发展。
2	《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》（工信部科〔2019〕188号）	工信部	2019 年	增强装备制造业质量竞争力。积极落实《促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南》。实施工业强基工程，着力解决基础零部件、电子元器件、工业软件等领域的薄弱环节，弥补质量短板。
3	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 29 号）	发改委	2019 年	将“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”列入鼓励类产业。
4	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	中共中央	2020 年	推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展；深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。
5	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》	工信部	2021 年	到 2023 年，电子元器件销售总额达到 21000 亿元，进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位，充分满足信息技术市场规模需求。
6	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	全国人民代表大会	2021 年	培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。

（二）行业主要特点及发展趋势

1、电子元器件和电路模块的国产化需求快速提升

2018 年以来，国际贸易形势日趋紧张，美国针对中国部分企业及相关产品实施制裁，覆盖航天、航空、通信、电子、机械等多个领域，并开始限制关键电子元器件和电路模块的出口。为尽快实现上游核心供应链的自主可控，保障产品供应持续性、生产经营安全性和采购价格稳定性，众多终端设备厂商开始将配套供应链向国内转移。“十四五规划”中明确提出“坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化”、“聚力国防科技自主创新、原始创新”，以及“培育壮大核心电子元器件等产业水平”等，从而推动我国核心电子产业自主

可控和国产替代进程。

根据工信部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》，到 2023 年，我国电子元器件销售总额需达到 2.1 万亿元，进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位，并形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业，力争 15 家企业营收规模突破 100 亿元。

随着国际贸易环境变化和国内政策的推动下，我国核心电子产业的自主可控和国产替代进程将进一步加速，从而大幅增加下游电子元器件和电路模块的需求。

2、国内电子元器件和电路模块行业的高端化成为趋势

2021 年 3 月，中共中央发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“十四五规划”），将发展现代化制造业体系提到新的高度，明确提出“深入实施制造强国战略”、“推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展”、“深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化”。电子元器件和电路模块是我国制造业高端化、信息化、智能化发展的关键，其性能直接影响各类工业装备、终端产品的性能与可靠性，尤其是高可靠领域，对电子元器件和电路模块的性能、质量等要求更高，因此，国内电子元器件和电路模块行业的高端化成为必然趋势。

此外，5G 的商用、汽车产业和工业装备智能化水平提升、智能物联网设备的普及均使得高端电子元器件的需求大幅提升；同时，疫情在全球蔓延导致国外电子元器件厂商的生产受到较大冲击，被美国、日本、韩国等发达国家长期占据的高端市场逐渐向国内转移，进一步加速国内电子元器件和电路模块行业的高端化。

3、企业综合能力成为电子元器件和电路模块供应商的核心竞争力

电子元器件和电路模块是现代化产业发展的重要支柱，下游客户对供应商的综合能力要求较高，具体包括：产品质量、产品多样性、快速响应能力、企业研发实力等。

（1）产品质量

电子元器件和电路模块的质量直接影响各类工业装备、终端产品的性能与可靠性，尤其是高可靠领域，对电子元器件和电路模块的性能、质量等要求更高，因此，产品质量成为下游客户考虑供应商的核心要素之一。

（2）产品多样性

电子元器件和电路模块的应用领域广泛，不同应用场景对其外观形态、材料构成、性能指标的要求均不同。下游厂商往往倾向于与具备多种电子元器件和电路模块供货能力的供应商进行长期合作，以保证其原材料供应的稳定性和一致性。

（3）快速响应能力

电子元器件和电路模块供应商交货速度对于下游用户至关重要，也是体现供应商价值的重要部分。稳定及时供货是对供应商的基本要求，而供应的灵活性则要求供应商有计划性备货或在下游用户计划变化时能给予调货支持。供应商在交货和客户服务等方面的快速响应能力是获得下游客户认可的关键要素。

（4）企业研发实力

高可靠领域，以及通信、消费电子、汽车电子和工业装备等行业均为高新技术领域。下游行业的技术快速更迭，使得包括公司在内的上游电子元器件和电路模块供应商需不断更新和适应新技术的发展，在能够准确把握市场和客户需求变化，适时布局新产品的同时，亦不断研发新工艺。

（三）行业竞争情况

1、市场竞争格局

我国坚持“小核心、大协作”的国防发展战略，为了吸收先进科技成果和先进生产力为国防建设服务，国家积极鼓励民间资本进入高可靠领域，充分发挥市场化分工协作的比较优势。各大央企集团及下属单位主要负责整机及相关系统的研制与生产，民营企业更多专注于专业化的小型系统级产品、核心模块和核心元器件的研发与生产，少量民营企业也进入到涉密程度较低的整机生产领域，国有企业集团与民营企业形成了有利的补充与良性互动关系。由于高可靠产品应用领域特殊，国产化要求较高，国产产品在高可靠领域的竞争力较强。

由于行业进入难度较大,我国高可靠电子元器件市场份额主要由少数生产厂家占有。以公司主要产品钽电容为例,2005 年以前的钽电容器市场的市场份额主要由国有企业占有。2005 年以后,公司通过产品的不断完善、技术的不断革新、品质的不断提升、市场销售力度的不断加大,在国内高可靠钽电容器领域的经营规模不断扩大,2020 年公司在电子元件百强企业排名 29 名,在钽电容器生产厂家中位居前列。同时,公司作为民营企业具有更加灵活的机制及市场化程度更高,预计未来公司市场占有率将进一步提升。

2、公司主要竞争对手情况

(1) 振华科技(000733.SZ)

中国振华(集团)科技股份有限公司(“振华科技”)主要从事电子信息产品的研制、生产和销售,主要产品包括片式阻容感、半导体分立器件、机电组件、厚膜混合集成电路、高压真空灭弧室、断路器及特种电池等门类。1997 年 7 月 3 日,振华科技为在深交所中小板上市,股票代码 000733.SZ。中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司为振华科技子公司,主要产品为高可靠性的钽、铝电解电容器、小功率脉冲变压器、平面变压器等电子元器件产品,与公司主要产品存在一定的相似性。

根据振华科技的 2020 年度报告及 2021 年半年度报告,2020 年度及 2021 年 1-6 月,振华科技分别实现营业收入 39.50 亿元及 28.17 亿元,净利润 6.02 亿元及 5.18 亿元;2020 年度,中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司实现营业收入 8.84 亿元,净利润 2.05 亿元。

(2) 火炬电子(603678.SH)

福建火炬电子科技股份有限公司(“火炬电子”)主要从事电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务。自产产品包括陶瓷电容器、钽电容器、陶瓷材料、微波薄膜元器件等,贸易类产品包括大容量陶瓷电容器、钽电解电容器、金属膜电容器、铝电解电容器、电感器、双工器、滤波器等。2015 年 1 月 26 日,火炬电子在上交所主板上市,股票代码 603678.SH。

根据火炬电子的 2020 年度报告及 2021 年半年度报告,2020 年度及 2021 年

1-6 月，火炬电子分别实现营业收入 36.56 亿元及 24.12 亿元，净利润 6.31 亿元及 5.64 亿元。2020 年度，火炬电子自产元器件营业收入为 10.65 亿元，其中陶瓷电容器、钽电容器营业收入分别为 8.71 亿元和 0.51 亿元。

(3) 鸿远电子（603267.SH）

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（“鸿远电子”）是以多层瓷介电容器等电子元器件的技术研发、产品生产和销售为主营业务的民营企业。自产产品主要包括多层瓷介电容器以及直流滤波器，代理产品主要为多种系列的电子元器件。2019 年 5 月 15 日，鸿远电子在上交所主板上市，股票代码 603267.SH。

根据鸿远电子的 2020 年度报告及 2021 年半年度报告，2020 年度及 2021 年 1-6 月，鸿远电子分别实现营业收入 17.00 亿元及 12.51 亿元，净利润 4.86 亿元及 4.54 亿元。2020 年度，鸿远电子自产电子元器件营业收入为 8.86 亿元，其中瓷介电容器营业收入为 8.75 亿元。

四、发行人主要业务模式、产品的主要内容

（一）发行人的主要业务模式

1、采购模式

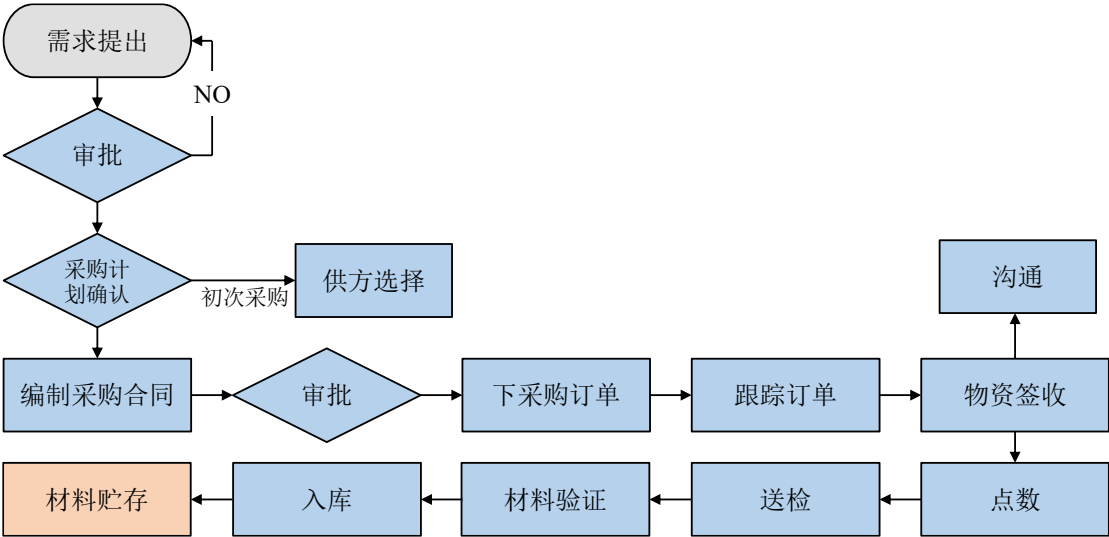
（1）供应商评选

公司采购部根据技术部制定的材料规范，通过各种渠道收集公司所需关键和重要材料供应商的相关资质证明材料，经分析后，选定质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供方。采购部要求候选供方提供少量样品、初步报价及有关质量证明资料，必要时通过公司技术负责人与供方技术负责人进行技术沟通交流确定。事业部、技术部组织对样品进行工艺摸底试验。材料经摸底试验合格后，质量部组织各部门对供方进行评价，出具《供方评价表》经批准后，列入《合格供方名单》。

对于进入《合格供方名单》的供应商，质量部定期组织相关人员对供方进行二方审查，了解供方的企业管理、技术力量、工艺设备、质量管理、计量等级、生产现场、产品质量、企业信誉、销售服务、包装运输、供货能力等情况。

（2）采购执行

公司制定了《采购控制程序》，对采购过程进行了有效控制，确保选用的材料符合有关的技术文件、生产设备的规定，满足产品相关的质量要求。公司采购部专门负责公司的采购工作，具体采购流程如下：



2、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，以销售订单或高可靠科研项目形式接入生产任务，根据客户往年的订单数量或重点型号产品趋势制定季度或年度生产计划，并发放到各条生产线作为参考。根据上月订单情况由销售内勤部门制定每月预发货计划并发放到生产线，由各生产线的生产主管根据月预发货计划制定当月的生产计划（周计划或日计划）并安排具体的生产任务。执行过程中采取流程式生产作业，在流程的各个关键点设置质量控制点，保证产品按照订单要求按期交付给客户，并且确保产品的可靠性和质量稳定性。

公司通过了 GJB9001C-2017 国军标质量体系认证、IATF 16949 汽车质量管理体系认证、AS9100D 航空航天质量管理体系认证等，在整个生产过程中采用优化设计和先进的质量管理技术，制定质量控制流程，如原材料入厂检验、设备和仪器仪表定期计量校验、生产环境的检测和控制、关键控制点的质控、产品按照国军标要求进行质量一致性检验等对全过程进行质量监控和管理；从投产到出货使每一个工序过程处于受控状态，以确保整个质量的稳定性和可靠性。

3、销售模式

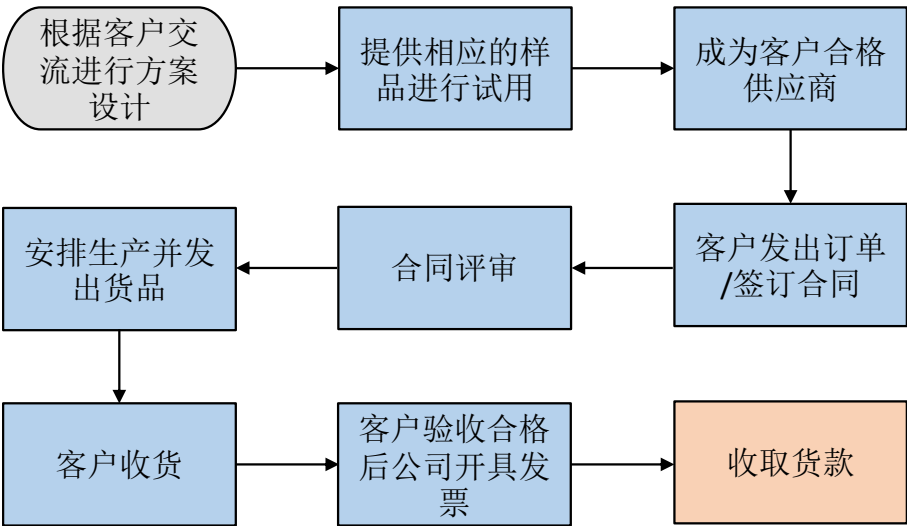
(1) 直销模式

公司产品主要通过直销模式销售给高可靠领域客户。目前，公司销售区域已覆盖全国大多数省市，同时，公司每个年度积极参与国内的特种电子元器件展览会，以提高产品知名度。

装备生产前期的用户设计方案确定阶段至关重要，是顺利实现向高可靠领域用户销售产品的关键，公司需要反复与用户就方案设计需求进行沟通交流，并提供合适的产品，符合用户要求后才能最终被编入其装备设计图纸选用的供应商目录。因此，公司销售部门与生产研发部门合作紧密，一方面可以更好的针对客户需求进行相应产品销售，另一方面可以及时向公司反馈客户及市场的改进要求与研发需求，帮助公司掌握市场需求与动向。

为了提高公司销售团队实力，公司对销售人员进行了专业知识培训。同时公司通过市场调研，确定销售重大方向，销售人员需要制定详细的行动方案，并定期汇报落实情况，公司对落实情况进行评估并相应进行指导。

公司的基本销售流程如下：



(2) 经销模式

公司部分民用产品采用经销的销售模式。民用产品在通过经销模式销售给下游客户时，由于经销商能够销售不同类型、不同品牌的电子元器件产品，从而能

满足民品客户供货量大、产品齐全和价格较低的要求。

4、研发模式

研发方面，公司以客户需求为牵引，密切关注国内外行业、竞争对手发展情况，不断引进行业内高端核心人才实现新产品的自主开发，在涉及基础及材料领域与高校和科研院所合作，进行联合开发。

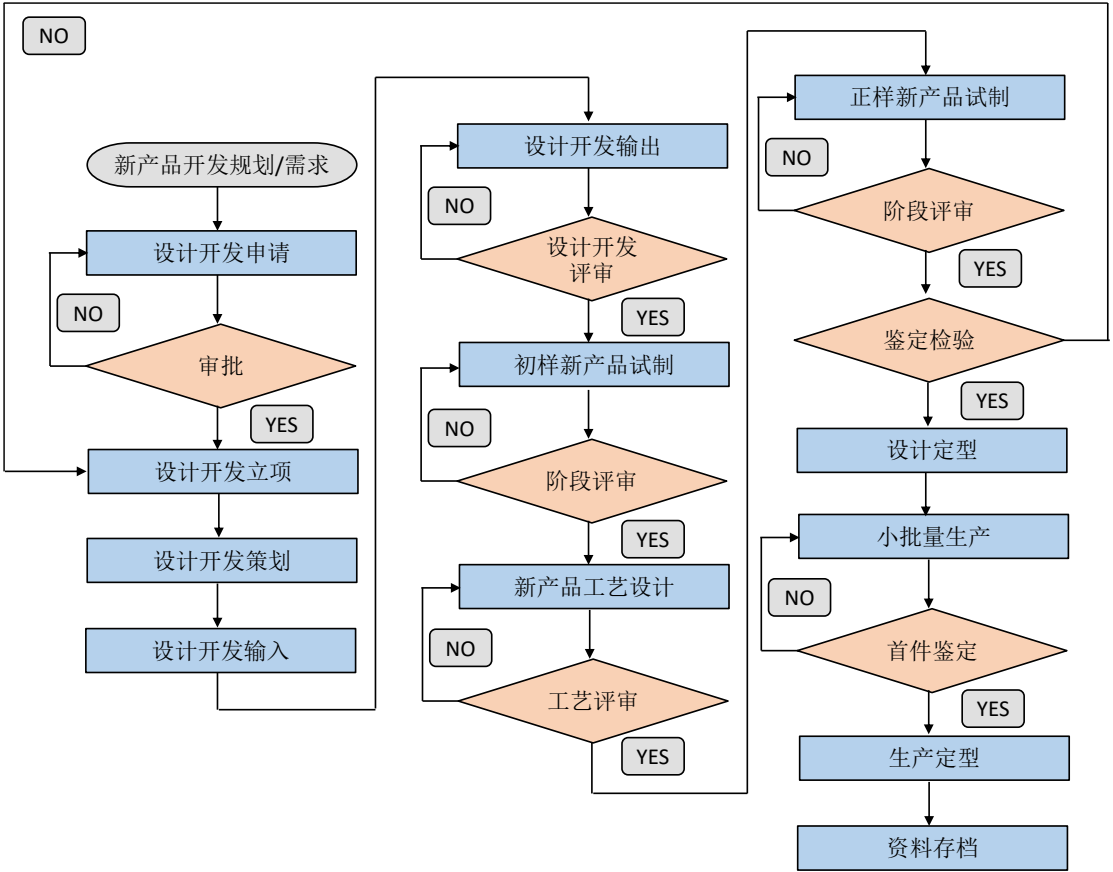
公司目前研发项目的设立主要包括以下几类：

（1）公司根据市场反馈和对海外同行业厂商跟踪信息收集，了解市场客户需求和行业动态，并据此制定研发项目，开发新产品。

（2）公司申请或接受政府部门或者高可靠单位的研发项目，该类项目由相关部门拨款。

公司根据 GJB9001C-2017、AS9100D 等体系标准中关于研究开发控制的要求，制定并严格执行《设计和开发控制程序》对研发的各个环节进行严格控制，从而确保将技术创新转化为技术成果。

公司具体研发流程图如下：



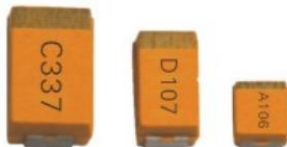
(二) 发行人的主要产品

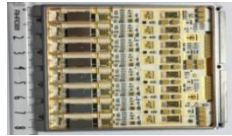
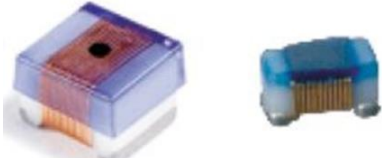
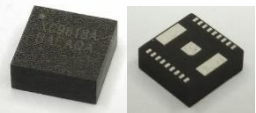
1、主要产品的内容或用途

公司主要产品为钽电容器、陶瓷电容器、微电路模块和其他电子元器件，其中钽电容器根据产品技术类型可分为非固体电解质钽电容器和固体电解质钽电容器。

公司主要产品类型及用途如下表所示：

类型	产品名称及主要型号	产品特征	应用
非固体电解质钽电容器系列	钽外壳封装系列（THC、CAK39、CAK38 系列） 	全钽结构、体积小、质量轻、内阻小、超大容量、可靠性高。	单体体积能量密度大，在能量转换电路和功率脉冲电路中可以发挥电池作用，为电路提供储能、断电延时及滤波等功能，适用于航天、航空、兵器等可靠电子设备，非常适用于航空设备中 50ms 断电延时的要求。
	银外壳封装系列（CAK30、CAK35 系列）	性能稳定可靠、寿命长，具有良	单只电压高，容量较大，适用于兵器、通讯、电子等有

类型	产品名称及主要型号	产品特征	应用
		好的耐恶劣环境和贮存性,漏电流小。	可靠性要求的电子设备的直流或脉动电路。
固体电解质钽电容器系列	片式固体电解质钽电容器系列 (CAK45 系列) 	体积小、重量轻、电性能优良稳定、寿命长、可靠性好、贮存稳定性好,质量稳定。	广泛应用于航空、航天、卫星、导弹、雷达等领域,是高可靠武器装备数字化、小型化、智能化不可缺少的电子元器件之一。
	片式高分子固体电解质钽电容器系列 (CAK55、CAK66 系列) 	导电高分子聚合物电解质、超低 ESR、高频容量保持、耐大纹波电流、良性失效模式。	高频性能优良、可靠性高,可以很好地满足电子技术及发展需求以及武器装备的小型化、轻型化和高性能化的需要,是钽电容器的发展趋势。
	非片式固体电解质钽电容器系列 (CAK、CAK41、CA42 系列) 	高低温特性好,性能稳定可靠,产品耐恶劣环境以及贮存性优良,价格较低。	适用于通讯、电子、船舶等有可靠性要求的电子设备的直流或脉动电路。
陶瓷电容器	多层片式瓷介电容器系列 	无极性、寿命长、可靠性高。	适用于各类高可靠及民用电电子设备中的谐振回路、耦合电路及要求低损耗、容值稳定性高和绝缘电阻高的电路中。
	单层陶瓷电容系列 	无极型、尺寸小、重量轻、工作频率高、损耗低、可靠性高	广泛应用于航天、航空、雷达、电子对抗、光通讯模块、微波毫米波通讯及其 T/R 组件模块中。
微电路模块	电源微电路模块 HQ 系列 DC/DC 变换器	功率密度非常高且性能较好	广泛应用于通信、自动控制和计算机中。

类型	产品名称及主要型号	产品特征	应用
			
	惯性微电路模块 (IF 系列、VF 系列) 	产品干扰能力强, 精度高, 温漂、时漂、电压敏感等性能优异	广泛应用于火箭、导弹、飞机、舰船、潜艇等惯性导航系统、姿态系统等。
	微波组件 	工作频率范围广、输出功率高、隔离度高、性能稳定、寿命长	广泛应用于雷达、通信等信息化设备中。
其他电子产品	电感器系列 	产品一致性好, 公差精度高	广泛应用于飞行器、车辆、船舶、雷达、电子等领域, 也广泛用于智能手机、工业控制设备、医疗设备、充电桩、笔记本电脑、仪器仪表、汽车电子等领域。
	电阻器系列 	体积小, 重量轻, 阻值低, 精度高, 温度系数低, 使用温度范围宽, 性能稳定, 质量可靠	广泛应用于各类检流电路、电源电路、驱动模块中等。
	电源管理芯片产品系列 	工作电压宽、阻抗小、集成度高、体积小、性能可靠、寿命长	广泛应用于航天、航空、雷达、车辆、船舶等领域。
	环行器隔离器 	体积小、频率覆盖范围广、温度特性好、精度高、一致性好、可靠性高	广泛引用与高可靠和民用微波通讯领域。

类型	产品名称及主要型号	产品特征	应用
	薄膜电容器系列 	耐压高、耐冲击、电流大、损耗小、ESR 和 ESL 小	主要应用于伺服驱动电源，起滤波储能作用、吸收反峰电压等作用，同时能抑制电源电磁干扰。
	嵌入式板卡 	产品应用带宽高、体积小、可靠性高	广泛应用于车载、舰载、机载、弹载等领域。
	微波芯片系列 	采用单片集成电路工艺，芯片体积小、重量轻、可靠性高	主要应用于各类装备的微波模组中，包括雷达、通信等装备的微波前端。
	温度传感器系列 	产品体积小，精度高，阻值漂移小，适用温度范围广，安装方便。	用于温度补偿、温度探测、检测、显示、温度控制、过热保护等领域。
	LTCC 滤波器系列 	体积小适合高密度贴装，使用频率范围广，高可靠度，良好的焊接特性和耐热性。	广泛应用于航空、航天、卫星、船舶、电子等领域的电子线路中，是高可靠装备数字化、小型化、智能化不可缺少的电子元器件。

2、发行人收入构成情况

报告期内，公司营业收入按产品类别分类构成如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
非固体电解质钽电容器	30,922.60	33.51%	49,422.19	35.28%	34,616.93	41.01%	26,099.23	41.02%
固体电解质钽电容器	25,032.65	27.13%	36,309.99	25.92%	25,277.53	29.95%	25,617.83	40.26%
微电路模块	9,275.63	10.05%	11,413.50	8.15%	5,449.81	6.46%	2,417.35	3.80%

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
陶瓷电容器	7,740.21	8.39%	12,160.62	8.68%	7,497.56	8.88%	4,080.99	6.41%
其他产品	18,521.65	20.07%	30,352.20	21.67%	10,094.55	11.96%	5,078.27	7.98%
主营业务收入	91,492.74	99.16%	139,658.49	99.69%	82,936.38	98.26%	63,293.67	99.47%
其他业务收入	777.21	0.84%	427.26	0.31%	1,467.79	1.74%	337.79	0.53%
合计	92,269.95	100.00%	140,085.76	100.00%	84,404.17	100.00%	63,631.46	100.00%

3、主要产品的产能、产量及销量

报告期内，公司主要产品的产能、产量及销量情况如下：

产品	项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
非固体电解质钽电容器	产能(万只)	40.00	73.00	73.00	43.00
	产量(万只)	43.04	63.44	47.20	38.66
	销量(万只)	33.22	51.44	44.96	34.68
	产能利用率	107.60%	86.90%	64.66%	89.91%
	产销率	77.19%	81.08%	95.25%	89.71%
固体电解质钽电容器	产能(万只)	20,348.00	34,758.00	34,514.00	34,269.00
	产量(万只)	18,770.21	28,876.21	21,166.93	23,186.21
	销量(万只)	16,930.80	27,971.88	20,218.44	21,669.32
	产能利用率	92.25%	83.08%	61.33%	67.66%
	产销率	90.20%	96.87%	95.52%	93.46%
陶瓷电容器	产能(万只)	2,688.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00
	产量(万只)	2,217.98	3,365.80	2,186.17	2,055.23
	销量(万只)	2,116.76	2,712.43	1,839.99	1,065.91
	产能利用率	82.51%	80.60%	52.35%	49.22%
	产销率	95.44%	80.59%	84.17%	51.86%
微电路模块	产能(万只)	7.20	9.70	6.40	6.40
	产量(万只)	6.27	8.08	4.46	1.49
	销量(万只)	6.09	5.29	2.52	0.89
	产能利用率	87.14%	83.30%	69.69%	23.28%
	产销率	97.07%	65.47%	56.50%	59.73%

(三) 发行人主要原材料及能源采购情况

1、主要原材料采购情况

报告期内，公司主要原材料采购情况如下：

原材料	项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
钽粉	采购金额（万元）	7,583.00	8,072.17	5,185.64	8,078.99
	采购数量（千克）	18,304.28	21,043.59	11,795.54	20,735.57
	采购单价（元/千克）	4,142.74	3,835.93	4,396.27	3,896.20
集成电路	采购金额（万元）	5,396.68	6,685.85	3,106.76	1,336.15
	采购数量（支）	175,955	421,552	79,639	40,095
	采购单价（元/支）	306.71	158.60	390.11	333.25
钽外壳	采购金额（万元）	1,146.61	2,251.06	1,386.82	1,232.21
	采购数量（支）	149,912	252,254	173,782	148,181
	采购单价（元/支）	76.49	89.24	79.80	83.16
钽盖	采购金额（万元）	874.76	1,729.52	835.19	937.76
	采购数量（支）	163,190	294,440	171,303	162,040
	采购单价（元/支）	53.60	58.74	48.76	57.87
有引线银外壳	采购金额（万元）	420.90	700.45	438.21	366.90
	采购数量（支）	289,101	524,468	416,199	361,861
	采购单价（元/支）	14.56	13.36	10.53	10.14

2、主要能源采购情况

报告期内，公司主要能源采购情况如下：

能源	项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
电力	采购金额（万元）	908.48	1,688.76	1,477.33	1,424.86
	采购数量（万度）	1,396.66	2,725.93	2,252.23	2,167.18
	采购单价（元/度）	0.65	0.62	0.66	0.66
水	采购金额（万元）	74.91	182.44	104.90	89.05
	采购数量（万吨）	18.04	40.85	27.74	24.35
	采购单价（元/吨）	4.15	4.47	3.78	3.66

(四) 发行人生产经营所需的主要生产设备、房屋情况

1、主要生产设备情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司主要生产设备情况如下：

单位：万元

序号	设备名称	账面原值	账面净值	成新率
1	高速阴极粘接机	1,162.30	697.37	60.00%
2	高速阳极点焊机	1,083.05	649.82	63.12%
3	电容器高温老化系统	717.13	452.66	63.12%
4	连续式真空溅镀系统	598.00	388.70	65.00%
5	自动横向成型机	427.59	256.55	60.00%
6	自动钽电容浸烘干机	299.12	249.26	83.33%
7	120T 自动封装系统	238.94	215.04	90.00%
8	高速成形检测机	303.78	182.27	60.00%
9	片式钽电容引线成型编带机	302.09	146.89	48.63%
10	切筋老化测量机	165.52	148.97	90.00%
11	划片机	383.72	183.23	47.75%
12	贴片机	145.83	118.84	81.49%
13	沾银机	128.90	97.57	75.69%
14	磁控溅射镀膜系统	357.36	65.51	18.33%
15	铝箔叠层机	78.21	62.57	80.00%
16	视觉智能选别机	57.96	52.17	90.00%
17	全自动双电子束真空蒸发系统	78.63	49.80	63.33%
18	FLUKE 测试仪	76.23	41.93	55.00%
19	高精度多功能校准器	54.65	36.44	66.67%
20	激光显微镜	53.10	34.51	65.00%

2、主要房屋建筑物情况

(1) 自有房产

截至本募集说明书签署日，公司及子公司自有房产情况如下：

序号	房产证号	所有权人	面积 (m ²)	地址	用途
1	湘(2021)株洲市不	宏达电子	7,452.54	荷塘区新华东路 1297 号	工业

序号	房产证号	所有权人	面积 (m ²)	地址	用途
	动产权第 0020717 号				
2	湘(2018)株洲市不动产权第 0058388 号	湘怡中元	39,399.85	天元区规划五区	工业

(2) 租赁房产

截至本募集说明书签署日，公司及子公司主要租赁房产情况如下：

序号	承租方	地址	面积 (m ²)	租赁期限	用途
1	宏达电子	成都市武侯区武青西四路 3 号 2 栋 7 楼 701 号房	960.78	2021.07.01-2022.06.30	办公
2	宏微电子	陕西省西安市高新区天谷七路 88 号新加坡腾飞科汇城东楼九层 902 和 903 单元	349.00	2021.02.01-2022.01.31	办公
3	宏微电子	南山区前海路泛海城市广场 2 栋 1004	234.70	2021.02.01-2022.01.31	办公
4	容电电子	联东 U 谷苏州三信项目 1#501	1436.68	2021.01.01-2022.12.31	办公
5	卓芯科技	高新西区天映路 11 号 3 栋 9 层 901-903 号	614.02	2021.08.01-2022.07.31	办公

(3) 在建工程

截至本募集说明书签署日，公司及子公司在建工程情况如下：

①新型电子元器件扩能（一期）精加工车间一及辅助用房项目

2019 年 6 月 13 日，公司取得株洲市荷塘区发展和改革局核发的《株洲市荷塘区发展和改革局关于新型电子元器件扩能项目备案的通知》（备案编号：株荷发改备[2019]21 号），准予对公司报送的新型电子元器件扩能项目进行备案。

2019 年 12 月 5 日，公司取得株洲市自然资源和规划局核发的建设工程规划许可证（建规[建]字第株规建[2019]0148 号），建设项目名称为新型电子元器件扩能（一期）精加工车间一及辅助用房；建设位置为新华路以东、金钩山路以北；建设规模为 14,816.09 平方米。

2020 年 3 月 17 日，公司取得株洲市住房城乡建设局核发的建筑工程施工许

可证（编号：430200202003170301），工程名称为新型电子元器扩能（一期）精加工车间一及辅助用房；建设地址为新华路以东、金钩山路以北；建设规模为14,816.09平方米。

2021年5月24日，公司取得湖南省株洲市建设工程联合验收合格证明，经株洲市住房和城乡建设局组织相关联办单位对本建设工程项目进行资料审查和现场踏勘后，一致认为符合要求、验收合格。

②天易科技城厂房项目

2020年9月1日，公司与株洲天易建设发展有限公司签订《天易科技城自主创业园厂房买卖合同》，约定公司向株洲天易建设发展有限公司购买天易科技城K2地块3、4、5、6号四栋标准厂房，总建筑面积为43,223.6平方米。

2021年5月14日，公司取得株洲市天元区住房和城乡建设局核发的建筑工程施工许可证（编号：430211202105140101），工程名称为K5号栋厂房室内装修工程；建设地址为株洲市天元区天易科技城自主创业一期K2地块；建设规模为2,980.00平方米。

2021年6月10日，公司取得株洲市天元区住房和城乡建设局核发的建筑工程施工许可证（编号：430211202106100101），工程名称为K4厂房室内装修工程；建设地址为株洲市天元区天易科技城自主创业一期K2地块；建设规模为8,563.53平方米。

就上述厂房所在地块卖方株洲天易建设发展有限公司通过国有土地使用权挂牌出让方式已取得土地使用权，并依法进行土地使用权使用登记取得土地使用权证。根据前述合同约定，公司将于付清全部款项后3个月内办理不动产权证过户。根据株洲天易建设发展有限公司出具的说明，公司不存在违反合同约定的行为，其将在合同约定的办理四栋厂房产权证书条件达成之日，全力协助宏达电子办理取得前述四栋厂房的产权证书。根据株洲市天元区自然资源局出具的证明，公司将在园区内全部厂房建设完成后，办理厂房的产权证书。

③军民电子创新产业基地项目

军民电子创新产业基地项目系成都市双流区人民政府招商引资项目，成都宏

电于 2018 年 5 月与成都双流区人民政府签订了投资协议书。

2020 年 4 月 20 日，成都市双流区发展和改革局对成都宏电填报的株洲宏达电子股份有限公司军民电子创新产业基地项目一期项目准予备案。拟开工时间为 2019 年 11 月，拟建成时间为 2022 年 11 月。

根据成都宏电与成都市双流市军民融合产业园区管理委员会签订的《国有建设用地项目履约协议书》，成都宏电应于 2020 年 6 月 30 日对项目开始动工。成都宏电为确保不违反协议的约定，在未取得建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证的情况下，先行对项目进行了建设。成都市双流区住房和城乡建设局对上述情况知情，并且为保证施工质量和施工安全，向质监站、安监站出具提前介入进行质量、安全监督服务的工作联系单。

2021 年 7 月 15 日，成都宏电取得成都市双流区规划和自然资源局核发的建设工程规划许可证（建字第 510122202131384 号），建设项目名称为株洲宏达电子股份有限公司军民电子创新产业基地项目一期（2018-510122-41-03-302244）；建设位置为成都市双流区东升街道永乐村五、六组，九江街道蛟龙社区七组；建设规模为 152,970.95 平方米。

2021 年 8 月 24 日，成都宏电已取得军民电子创新产业基地项目的施工许可证。

（五）发行人核心技术情况

公司的研发人员积极吸收国际前沿技术，针对高可靠元件进行自主研发，根据市场需求状况、国内外先进技术研发方向和市场反馈信息，通过自主创新、技术积累和改进优化不断提升核心技术的应用水平，拓展核心技术的应用领域。

公司自成立以来一直致力于高可靠电子元器件的研究开发工作，目前在高可靠钽电容器领域具有较强的研发能力，在片式固体电解质钽电容器、高能钽混合电容器和高分子固体钽电容器等小型化、高性能化钽电容器领域具有技术优势，自主研发的 THC 系列高能钽混合电容器和高分子固体钽电容器填补了国内空白，处于国内领先地位。

非钽电容业务方面，公司在陶瓷电容器、环行器及隔离器、微电路模块、嵌

入式板卡、LTCC 滤波器、薄膜电容器、温度传感器等系列产品上均实现了技术突破，形成了多元化的核心技术体系。

公司在长期的研发实践中，逐渐掌握了以下各项核心技术：

序号	核心技术名称	技术现状、水平描述	技术来源
钽电容领域：			
1	高能钽混合电容器赋能技术	通过采用多级赋能技术，改善了氧化膜的质量，提高产品的可靠性，该技术已广泛应用于该产品的各种型号规格产品中，技术水平为国内领先。	自主研发
2	高能钽混合电容器成型技术	传统的阳极引出线为一根直钽丝，为了保证烧结后，阳极引出线能与芯块接触良好，具有较低的接触损耗角，公司将钽丝设计成不同形式，使烧结后的钽丝不会在阳极芯块内部转动，改善阳极芯块的容量、损耗角正切值和 ESR 值等性能参数。该技术已广泛应用于该产品的各种型号规格产品中，技术水平为国内领先。	自主研发
3	非固体电解质钽电容器赋能过程电流电压控制技术	该技术优化了阳极赋能形成液的电导率，使得在保证电容形成效率的前提下，进一步提高形成液的闪火电压，提高成品电容的可靠性。该技术主要应用于非固体电解质钽电容器生产线上的各型号电容，技术水平为国内领先。	自主研发
4	非固体电解质钽电容器电解液配制技术	该技术通过对赋能形成电流、电压、时间的优化，确保了电容芯块的电容量和漏电流满足标准要求，并降低了漏电流。该技术主要应用于非固体电解质钽电容器生产线上的各型号电容，技术水平为国内领先。	自主研发
5	非固体电解质钽电容器赋能形成液配制技术	该技术对非固体电解质钽电容器中的硅溶胶、硫酸及其他添加剂配方的不断优化，摸索出一套闪火电压满足电容要求而又能降低 ESR 的电解液体系，达到了国内先进水平。主要应用于非固体电解质钽电容器生产线上的各型号电容。	自主研发
6	固体电解质钽电容器介质膜形成技术	该技术解决了五氧化二钽介质膜形成质量不一致的问题，通过热处理释放了内部应力，提高了介质膜耐受热应力的能力，达到了国内先进水平，应用于固体电解质钽电容器生产线上的各型号电容。	自主研发
7	固体电解质钽电容器二氧化锰阴极被覆技术	该技术通过调整浸渍硝酸锰的溶液比重、浸渍时间以及次数，解决了产品容量引出率偏低，损耗一致性不好的问题，达到了国内先	自主研发

序号	核心技术名称	技术现状、水平描述	技术来源
		进水平，主要应用于固体电解质钽电容器生产线上的各型号电容。	
8	片式高分子聚合技术	该技术解决了片式高分子钽电容器国产化问题，填补了国内高分子钽电容器的空白。	自主研发
9	片式钽电容高压制密度下的阳极钽块成型技术	解决了钽阳极块压制时容易出现缺角、缺块、疏松等技术难题，提高了成型工序合格率，该技术达到了国内先进水平。	自主研发
10	片式钽电容高压制密度下金属氧化膜形成工艺技术	解决了产品在赋能过程中性能一致性问题，生成的五氧化二钽介质氧化膜完好致密，减小漏电流大和老化击穿的废品比例，该技术达到了国内先进水平，提高产品质量可靠性。	自主研发
11	片式钽电容高致密阴极 MnO_2 固体电解质沉积技术	解决了漏电流大、电容量超标及介质损耗因数大的技术难题，提高耐压值及参数的一致性，该技术达到了国内先进水平。	自主研发
非钽电容领域：			
12	改性陶瓷材料技术	该技术基于纳米级的钛酸钡陶瓷料改性，在不同孔径筛分配比的陶瓷粉料基础上添加稀土金属氧化物改性，实现小型化大容量等设计目标。	自主研发
13	超薄膜层流延技术	该技术是以 PET 膜为基体，将流延、印刷、叠层整合成一条完整的流水线，可实现全自动操作。使流延膜片厚度控制最小至 $1\mu m$ 。达到国外先进厂家同等水平。	自主研发
14	瓷介电容器高层数大容量叠层技术	该技术解决了高层数大容量产品叠层时陶瓷介质膜片与 PET 膜难分离的现象，应用该技术可使叠层层数达到 1000 层，攻克了瓷介电容实现大容量生产的工艺难关，技术水平为国内领先。	自主研发
15	细微晶粒烧结技术	烧结的主要目的是利用高温把陶瓷粉体转为致密固体。烧结过程中重要的控制参数有：氢气和氮气流量、烧结温度和时间。通过这些参数，烧结获得设计的晶粒大小、晶界宽度等参数，从而控制最终产品的电性能和机械性能。	自主研发
16	金属电极共烧技术	该技术解决了产品在烧结时因收缩不一致出现内部开裂的现象，通过调整配方工艺、层压工艺、烧结曲线达到了产品实现共烧的目的，技术水平为国内领先。	自主研发
17	高致密磁控溅射技术	磁控溅射的主要目的是在陶瓷表面制备金属薄层。通过控制基片温度、溅射气压、溅射时间和溅射功率等，获得设计后的厚度的高	自主研发

序号	核心技术名称	技术现状、水平描述	技术来源
		致密高结合力的金属薄层。	
18	基于 LTCC 的滤波器设计技术	其技术采用多层陶瓷工艺，可以把无源器件置于介质基板的内部，同时可以把有源器件贴装于介质基板表面，从而制作成无源/有源集成的功能模块。其在集成封装、布线宽度和间距、低阻抗金属化、设计的灵活性和多样性、高频率性能方面都有着明显优势。	自主研发
19	高分子片铝阴极聚合技术	该技术是以 3, 4 乙烯二氧噻吩为载体，通过控制温湿度、催化剂含量氧化还原反应生成导电聚合物，附着在三氧化二铝表面形成阴极，达到国外先进厂家同等水平。	自主研发
20	隔离器环行器小型化表贴设计技术	根据微波信号波长与介电常数紧密相关的原理，采用高介电常数旋磁基片及截至嵌套复合基板，对小型化微波集成电路进行重新设计，产品的外形尺寸可以进行有效的缩小。并根据微带转同轴的接口设计技术，将位于表面的传输线通过标准 50 欧姆同轴口转移为器件背面，可以同用户的使用环境匹配更优，解决用户使用过程中的匹配问题。	自主研发
21	薄膜铁氧体电路制备技术	通过精确全自动溅射设备的清洗参数、溅射功率、气体流量等工艺参数，将靶材金属均匀致密的沉积在基片上，达到设计成膜均匀性，不同批次间膜层重复性，铁氧体薄膜电路附着力，满足了星载产品要求，属于国内行业的最高标准。	自主研发
22	高精度电流频率转换设计技术	采用独特的温度补偿技术，使产品精度达到了国内先进水平。	自主研发
23	电容器渐变金属化极板图案设计技术	根据电容器的不同特点设计不同的金属化图案进行真空蒸镀，控制规定的厚度（方阻），从而充分发挥金属化薄膜特性，保证其抗电流能力的同时充分发挥其自愈性，提高击穿场强。	自主研发
24	热处理调整卷绕张力技术	实现了卷绕张力和热处理工艺中温度设置的有效配合，以及芯子压扁时，温度、时间和压力大小的相互配合。该两项工艺的实施提高了电容器的容量稳定性，提高了充放电次数并延长了储存寿命。	自主研发
25	温度传感器芯片厚膜印刷技术	采用了第三代厚膜印刷技术，具有机械性能好、参数稳定、响应时间快等特点。	自主研发

五、现有业务发展安排及未来发展战略

(一) 公司整体发展战略

公司立足于高可靠电子元器件和电路模块的研发、生产和销售,经过多年的技术创新和经验积累,公司已成为国内高可靠电子元器件细分领域的龙头企业,其中钽电容器产品已达到国内领先水平,拥有较高的市场占有率和品牌知名度。同时,公司逐步以子公司的形式孵化其他类型电容器、电感器、电阻、环行器与隔离器、电路模块等众多产品,并且加大民用市场开拓,形成了较为完善的横向布局的发展战略。

公司秉承“宏诚信品格、达可靠品质”的经营理念 and 方针,坚持以市场需求为导向,以技术创新为支撑,以产品质量为保障,不断提高电子元器件和电路模块的研发和产业化能力,为下游大型高可靠集团和通信、消费电子、汽车电子、工业装备等领域的大型终端厂商提供更全方位的解决方案。

(二) 公司未来发展目标

国家政策方面,我国制造业的高端化、信息化、智能化建设,以及核心电子产业的自主可控是我国实现“十四五”规划和 2035 年远景目标的重要组成部分;行业发展趋势方面,5G 网络建设、智能手机加速迭代、智能穿戴物联网设备普及和新能源汽车的快速发展为下游电子元器件和电路模块带来大规模新增需求。

公司将抓住国家政策和行业发展的历史机遇,充分发挥公司在高可靠电子元器件和电路模块领域积累的研发、设计和产业化能力,与众多大型高可靠集团,以及通信、消费电子、汽车电子和工业装备等领域的终端厂商密切协作,贯彻公司横向发展战略,进一步扩大产品半径,提高公司盈利能力的同时,支持我国制造业发展。

(三) 实现发展目标的路径和计划

1、研发和技术创新计划

自主研发能力及技术创新是公司赖以生存和发展的基础,也是核心竞争力最集中的体现。公司始终专注于电子元器件和电路模块领域相关技术的研究与开发,

未来将充分利用公司在高可靠领域的技术经验积累和产业链上下游深度融合的优势,打造完善的研发平台,紧跟下游行业发展趋势和客户产品需求,不断提高技术深度、扩大技术广度,为下游大型高可靠集团和通信、消费电子、汽车电子、工业装备等领域的大型终端厂商提供更全方位的解决方案。

2、产能扩张计划

近年来,随着高可靠领域,以及通信、消费电子、汽车电子和工业装备等下游行业的需求增加,公司主要产品的产销量大幅提升,最近三年营业收入复合增长率达 48.38%。2020 年,公司陶瓷电容器和环行器及隔离器的产能利用率均处于较高水平。公司将通过本次募投项目提升多个产品产能,改善产能饱和的现状,满足现有客户的需求的同时,拓展各领域的新客户,提升公司的盈利能力和综合竞争力。

3、人才培养和引进计划

公司始终将人才队伍建设作为企业发展的重要战略之一,建立了良好的人才培养制度。未来公司将继续完善人才培养体系,加快专业人才的培养;与行业内知名企业、科研院所进行技术交流,并聘请领域技术专家对公司员工进行指导,助力公司深化实施横向发展战略。同时,公司将通过内部培训和外部交流等方式,提升员工综合实力,建立更有效的激励机制,积极营造有利于技术创新的工作环境。

4、市场拓展计划

公司实施聚焦客户需求与差异化的产品开发策略,坚持以客户需求为导向,以技术创新为支撑,将产品、技术与服务优势作为公司营销渠道建设的基础。同时,公司将进一步完善全国重点区域的营销网络布局,增加业务人员,细化销售管理。公司将实施重点客户销售策略,集中优势资源专注于服务重点客户,通过提供符合重点客户要求 and 市场发展需求的产品,协助其提升技术创新水平,加快发展步伐,以期建立双赢的战略合作关系。公司将进一步加强与产业链上下游核心合作伙伴的合作,巩固和提升已建立的战略合作伙伴关系,不断整合和优化产业链的资源配置,为更好地专注于自身核心竞争力的提升创造有利条件。公司在

巩固拓展高可靠市场的同时，将加强产品的性能与质量一致性，提高公司产品在民用市场的竞争力，加大力度开拓民用市场，努力实现高可靠和民品市场双轮驱动。

六、财务性投资情况

（一）自本次发行相关董事会前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资的具体情况

本次发行相关事项已经 2021 年 6 月 4 日召开的本公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了本次发行的相关议案，自本次发行董事会前六个月至本募集说明书签署日，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资情况。

（二）最近一期末持有的财务性投资（包括类金融业务）情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司财务报表中可能涉及财务性投资（包括类金融业务的投资）的主要科目如下：

单位：万元

序号	科目	截至 2021 年 6 月 30 日金额
1	交易性金融资产	2,085.55
2	其他应收款	2,377.86
3	长期股权投资	725.15
4	其他非流动金融资产	500.00
5	投资性房地产	17.84
6	其他非流动资产	11,310.14

1、交易性金融资产

截至2021年6月30日，公司交易性金额资金为2,085.55万元，均为风险较低的银行理财产品，不属于收益波动大且风险较高类型，不属于财务性投资。

2、其他应收款

截至2021年6月30日，公司其他应收款为2,377.86万元，主要为尚未收到的政府补助、押金、备用金、代扣代缴款、往来款等，不属于财务性投资。

3、长期股权投资

截至2021年6月30日，公司长期股权投资为725.15万元，主要为持有展芯半导体48.58%的股权和持有宏讯微电子35.00%的股权，不属于财务性投资。

4、其他非流动金融资产

截至2021年6月30日，公司其他非流动金融资产为500.00万元，主要为持有株洲县融兴村镇银行10.00%股权，属于非金融企业投资金融业务，属于财务性投资。

截至2021年6月30日，公司合并报表归属于母公司净资产为245,063.95万元，公司其他非流动金融资产的账面金额为500.00万元，远低于发行人合并报表归属于母公司净资产的30%，即73,519.18万元，因此，上述其他非流动金融资产不属于金额较大的财务性投资。

5、投资性房地产

截至2021年6月30日，公司投资性房地产为17.84万元，为公司自2015年起租赁给株洲县融兴村镇银行的相关房产，不属于财务性投资。

6、其他非流动资产

截至2021年6月30日，公司其他非流动资产为11,310.14万元，主要为预付设备款、预付工程款等，不属于财务性投资。

综上，公司不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资(包括类金融业务)的情形。公司本次发行符合《创业板上市公司证券发行上市审核问答》有关财务性投资和类金融业务的要求。

七、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况

(一) 未决诉讼、仲裁

截至本募集说明书签署日，公司及子公司不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁事项。

（二）行政处罚情况

报告期内，公司存在被行政处罚的情况，具体如下：

2018年7月3日，株洲市荷塘区国家税务局税源管理一科向公司出具《税务行政处罚决定书（简易）》（株荷国税简罚[2018]517号），因公司未按期申报2016年7月1日至2016年9月30日期间的企业所得税（应纳税所得额），根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条，对发行人处以株洲市荷塘区国家税务局税源管理一科于2018年7月3日对发行人作出罚款100元的行政处罚。

根据公司提供的中国工商银行电子缴税付款凭证，公司已于2018年7月5日向株洲市荷塘区国家税务局缴纳罚款100元。

综上，公司上述受到行政处罚的情况金额较小且情节轻微，不属于重大行政处罚，对公司的生产经营不存在重大不利影响，相关处罚不构成重大违法违规或属于严重损害投资者合法权益、社会公共利益的行为。

第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

(一) 本次发行的背景

1、我国制造业高端化、信息化、智能化建设提速

2021年3月，中共中央发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称“十四五规划”），将发展现代化制造业体系提到新的高度，明确提出“深入实施制造强国战略”、“推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展”、“深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化”。

电子元器件和电路模块是我国制造业高端化、信息化、智能化发展的关键，其性能直接影响各类工业装备、终端产品的性能与可靠性，尤其是高可靠领域，对电子元器件和电路模块的性能、质量等要求更高。随着外部国际环境日益复杂，以及“十四五”期间“保持制造业比重基本稳定”和“推动制造业高端化智能化绿色化”的建设目标，预计我国制造业将保持稳定增长，且高端化、信息化、智能化趋势明显，从而带动上游电子元器件和电路模块的需求提升。

2、核心电子产业自主可控和国产替代加速

2018年以来，国际贸易形势日趋紧张，美国针对中国部分企业及相关产品实施制裁，覆盖航天、航空、通信、电子、机械等多个领域，并开始限制关键电子元器件和电路模块的出口。为尽快实现上游核心供应链的自主可控，保障产品供应持续性、生产经营安全性和采购价格稳定性，众多终端设备厂商开始将配套供应链向国内转移。“十四五规划”中明确提出“坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化”、“聚力国防科技自主创新、原始创新”，以及“培育壮大核心电子元器件等产业水平”等，从而推动我国核心电子产业自主可控和国产替代进程。

根据工信部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》，

到2023年，我国电子元器件销售总额需达到2.1万亿元，进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位，并形成一批具有国际竞争优势的电子器件企业，力争15家企业营收规模突破100亿元。

随着国际贸易环境变化和国内政策的推动下，我国核心电子产业的自主可控和国产替代进程将进一步加速，从而大幅增加下游电子元器件和电路模块的需求。

3、5G时代我国成为全球通信领域的领跑者

通信产业是现代社会发展的基石，每一代移动通信技术具备先发优势的国家，其国内通信产业链都占据了全球市场的主要份额。我国通信产业经历了2G、3G时代的追赶和4G时代的同步后，将在5G时代成为领跑者，国内通信产业链厂商将迎来新的发展机遇。

(1) 5G基站建设将增加电子元器件和电路模块的需求

通信基站是电子元器件和电路模块的重要应用领域。为满足5G时代增强型移动宽带(eMBB)、大规模机器类通信(mMTC)、低时延高可靠通信(uRLLC)等应用场景的需求，大规模天线技术(Massive MIMO)、超密集组网技术和全频谱接入技术等成为5G基站部署的核心技术。其中，大规模天线技术(Massive MIMO)是提升5G频谱使用效率的关键技术，使得基站天线由原来的2-8通道增长至64通道，从而大幅提升对电容器、环行器及隔离器等电子元器件以及各类电路模块的需求；超密集组网技术则将大幅提升通信基站的部署密度，增加基站数量，根据市场研究机构测算，5G基站建设规模将是4G基站的1.2-1.5倍，5G基站数量的增加将相应带动相关电子元器件和电路模块的需求；全频谱接入技术将增加5G网络的使用频段，不同频段均对应不同规格的电子元器件和电路模块，以支持信号在该频段的发射与接收，因此，5G网络更宽的频段将拉动通信基站对电子元器件和电路模块的需求。

(2) 5G商用带动智能手机加速迭代和智能物联网设备普及，拉动电子元器件和电路模块需求增长

5G的商用带动智能手机性能升级和功能增加，将大幅增加电子元器件的用量。此外，5G网络亦要求智能手机的频段增加，更多的频段则需要更大量的电

子元器件和电路模块，以支持5G时代的低时延、高可靠通信需求。

除智能手机外，5G商用亦推动了智能穿戴设备、智能家居设备等智能物联网设备的普及，成为消费电子领域新的增长点，进而拉动上游电子元器件和电路模块的需求增长。

4、新能源汽车的普及带动汽车电子的需求

汽车电子是电容器等电子元器件的重要应用领域，相比传统燃油车，新能源汽车的智能化程度更高，对电容器等电子元器件和电路模块的需求量也更大。我国已全面确立了2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标，在碳中和背景下，交通领域降低碳排放主要依靠公路运输的汽车电动化，新能源汽车将迎来广阔的增长空间。2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，目前新能源汽车销量占比仅5.4%，未来增长空间巨大。

随着新能源汽车的普及，汽车电子的需求量将持续上升，从而拉动电容器等电子元器件和电路模块的需求增长。

5、国外电子元器件厂商生产经营受疫情冲击较大，加速国内高端电子元器件崛起

电子元器件是现代化产业发展的重要支柱，国外电子元器件厂商具有较强的先发优势，高端市场多被美国、日本、韩国的厂商占据。2020年以来，疫情在全球蔓延导致国外电子元器件厂商的生产受到较大冲击，而5G和新能源汽车等领域的快速发展大幅提升了上游电子元器件的市场需求。下游需求旺盛和国外电子元器件厂商产能受限的背景下，国内高端电子元器件厂商将迎来良好的发展机遇。

（二）本次发行的目的

1、顺应国家政策和行业发展趋势，深化公司横向布局的发展战略

国家政策方面，我国制造业的高端化、信息化、智能化建设，以及核心电子产业的自主可控是我国实现“十四五”规划和2035年远景目标的重要组成部分。公司拥有20多年的电子元器件研发和生产经验，是国内高可靠电子元器件细分领

域的龙头企业之一，多年服务于高可靠领域多家大型集团。本次发行将有利于提高公司电子元器件和电路模块的研发实力和生产能力，从而支持我国制造业的高端化、信息化、智能化建设，以及核心电子产业的自主可控。

行业发展趋势方面，5G网络建设、智能手机加速迭代、智能穿戴物联网设备普及和新能源汽车的快速发展为下游电子元器件和电路模块带来大规模新增需求。本次发行将有利于公司抓住行业发展机遇，结合公司横向布局的发展战略，进一步提高新产品的研发实力和生产能力，丰富客户体系、扩大产品半径。

2、改善公司产能饱和情况，提升公司的盈利能力和综合竞争力

近年来，随着高可靠领域，以及通信、消费电子、汽车电子和工业装备等下游行业的需求增加，公司主要产品的产销量大幅提升，最近三年营业收入复合增长率达48.38%。2020年，公司陶瓷电容器和环行器及隔离器的产能利用率均处于较高水平。本次发行将提升上述产品的产能，有助于改善公司产能饱和的情况，满足现有客户的需求的同时，拓展各领域的新客户，提升公司的盈利能力和综合竞争力。

3、提升公司新产品和新工艺的研发能力，吸引和培养高端人才

公司下游的高可靠领域，以及通信、消费电子、汽车电子和工业装备等行业均为高新技术领域。下游行业的技术快速更迭，使得包括公司在内的上游电子元器件和电路模块供应商需不断更新和适应新技术的发展，在能够准确把握市场和客户需求变化，适时布局新产品的同时，亦不断研发新工艺。

技术创新是企业发展的持续动力，而高端技术人才则是企业技术创新的必要保证。公司所在行业属于技术密集型行业，研发人员需具备多方面的专业知识和技能，不断吸引和培养高端研发人才是公司发展的重要举措。

本次发行将有效提高公司新产品和新工艺的研发能力，吸引和培养高端人才，保障公司适应下游行业发展趋势。

4、增强公司资金实力，满足流动资金需求

公司下游客户主要为大型高可靠集团、通信、消费电子、汽车电子和工业装

备等领域的终端厂商,该类下游客户通常会将供应商的资金实力作为考虑其抗风险能力的重要指标之一,资金实力亦成为公司稳固在行业内市场地位的重要因素之一。

此外,公司与大型高可靠集团、通信、消费电子、汽车电子和工业装备等领域的终端厂商合作多年,建立了长期稳定的业务合作关系,但在业务合作过程中,前述客户一般回款周期较长,部分客户还以商业承兑汇票进行结算,从而占用较大规模的流动资金。

本次发行将有效提高公司的资金实力,满足生产经营中的流动资金需求。

二、发行对象及与发行人的关系

(一) 发行对象

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者,包括境内注册的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行申请获得深交所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定后,按照中国证监会、深交所的相关规定,根据竞价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

(二) 发行对象与发行人的关系

截至本募集说明书签署日,本次发行尚未确定具体的发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

(一) 发行价格及定价方式

本次发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。

本次发行的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权除息和股本变动事项，发行底价将进行相应调整。调整方式如下：

派息/现金分红： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0 / (1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D) / (1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行底价。

最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定及本次发行方案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若国家法律、法规或其他规范性文件对特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或者监管意见，公司将按照最新规定或者监管意见进行相应调整。

(二) 发行数量

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的10%，即4,001.00万股。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调

整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

(三) 限售期

本次向特定对象发行A股股票的发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

四、募集资金投向

本次发行股票募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资金额	募集资金投入金额
1	微波电子元器件生产基地建设项目	宏达电子	64,700.00	62,000.00
2	研发中心建设项目	成都宏电	20,400.00	18,000.00
3	补充流动资金	宏达电子	20,000.00	20,000.00
合计			105,100.00	100,000.00

若本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确

定发行对象与公司的关系,最终是否存在因关联方认购公司本次发行的股份构成关联交易的情形,将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

本次发行前,公司的控股股东及实际控制人为曾琛、钟若农和曾继疆,三人为一致行动人,合计直接持有公司286,000,000股股份,持股比例为71.48%。按照发行上限4,001.00万股测算,假设公司控股股东及实际控制人不参与认购,本次发行完成后本公司控股股东及实际控制人合计直接持有公司股份比例为64.98%,仍为本公司的控股股东及实际控制人。

因此,本次发行不会导致本公司控制权发生变化。

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次发行方案已经2021年6月4日召开的公司第二届董事会第二十次会议及2021年6月23日召开的公司2021年度第一次临时股东大会决议审议通过。

公司已于2021年7月19日收到国防科工局出具的关于株洲宏达电子股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见,原则同意公司本次资本运作。

根据《证券法》、《公司法》、《管理办法》以及《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,本次发行已通过深交所审核,尚需经中国证监会同意注册后方可实施。

在中国证监会同意注册后,公司将向深交所和登记结算公司申请办理股票发行、登记和上市事宜,完成本次发行全部呈报批准程序。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次发行募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资金额	募集资金投入金额
1	微波电子元器件生产基地建设项目	宏达电子	64,700.00	62,000.00
2	研发中心建设项目	成都宏电	20,400.00	18,000.00
3	补充流动资金	宏达电子	20,000.00	20,000.00
合计			105,100.00	100,000.00

若本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次发行募集资金投资项目的的基本情况

本次发行募集资金总额扣除发行费用后将用于微波电子元器件生产基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。本次募集资金投资项目具体情况如下：

（一）微波电子元器件生产基地建设项目

1、项目基本情况

项目名称：微波电子元器件生产基地建设项目

实施主体：宏达电子

项目投资额：64,700.00 万元

项目建设地：湖南省株洲市高新技术产业开发区天易科技城 K2 地块

项目主要内容：(1) 购置厂房、配套设施及环保设施；(2) 扩建陶瓷电容器、环行器及隔离器全流程生产线，购置国内外先进的生产设备，提高生产效率。

项目主要产品：本项目达产后，公司预计将新增陶瓷电容器产能 200,000.00 万只/年，新增环行器及隔离器产能 150.00 万只/年。

2、项目建设必要性

(1) 满足我国制造业高端化、信息化、智能化建设需求

近年来，随着信息化、智能化在制造领域的快速发展和应用，相应带动上游电子元器件的需求大幅上升。根据“十四五”期间“深入实施制造强国战略”、“推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展”、“深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化”等建设目标要求，我国制造业高端化、信息化、智能化进程正加速推进，预计未来对电子元器件的需求将进一步提高，对公司业务增长提供了良好的发展契机。

经过多年的技术创新和经验积累，公司已成为国内高可靠电子元器件细分领域的龙头企业，其中钽电容器产品已达到国内领先水平，拥有较高的市场占有率和品牌知名度，最近三年，公司钽电容器收入分别为 51,717.05 万元、59,894.45 万元和 85,732.18 万元，呈逐年上升趋势。近年来，公司在原有钽电容器产品保持领先地位的基础上积极推动产品横向布局，大力发展陶瓷电容器、环行器及隔离器等新产品，但目前产能规模仍较低，通过本次募投项目建设，将有效提高公司陶瓷电容器、环行器及隔离器产能，以满足我国制造业高端化、信息化、智能化建设需求。

(2) 实现国产替代并满足5G快速发展需求，进一步提高市场占有率

2018 年以来，国际贸易形势日趋紧张，我国政府和大量终端设备厂商意识到尽快实现上游核心供应链自主可控的重要性，我国政府相应提出一系列加速推进核心电子产业国产替代和自主可控的支持政策，“十四五规划”中明确提出“坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化”、“聚力国防科技

自主创新、原始创新”，以及“培育壮大核心电子元器件等产业水平”等。

此外，5G 时代，我国成为全球通信领域的领跑者，国内通信产业链厂商将迎来新的发展机遇，而陶瓷电容器、环行器及隔离器等电子元器件是 5G 基站的重要支撑零部件。因此，5G 基站的大规模建设和 5G 商用带来的终端电子产品需求增长将大幅提升上游核心电子元器件产品的市场规模。

公司陶瓷电容器和环行器及隔离器收入规模呈快速上升趋势，但目前产能规模仍较低，且产能利用率较高，无法满足下游客户持续的需求增长。通过本次募投项目建设，将有效提高公司陶瓷电容器和环行器及隔离器产能，充分响应国家实现自主可控的关键战略，以满足高端市场国产替代需求，进一步稳固市场地位。

（3）深化公司横向布局的发展战略，培育新的利润增长点

电子元器件是一切电子设备、电子信息系统和武器装备控制系统的基础，是现代化产业发展的重要支柱。电子元器件的种类繁多，市场空间广阔，以电容器为例，即包含陶瓷电容器、铝电容器、薄膜电容器、钽电容器等，其中陶瓷电容器的市场规模最大，根据中国电子元件行业协会数据，2019 年，我国陶瓷电容器占电容器市场规模的比为 54%，远高于其他类别电容器。

通过本次募投项目建设，将有效提高公司陶瓷电容器和环行器及隔离器产能，深化公司横向布局的发展战略，培育新的利润增长点。

3、项目建设的可行性

（1）公司研发实力较强，具备完善的技术储备

自成立以来，公司专注于高可靠电子元器件和电路模块的研发、生产和销售，产品性能国内领先，并拥有完整的高可靠电子元器件和电路模块应用技术体系。伴随着下游行业技术的演进和客户需求的升级，公司不断改进和提升产品性能，从而实现收入持续快速成长。在陶瓷电容器领域，公司自 2014 年开始研究陶瓷电容器的设计和生产，目前已拥有改性陶瓷材料技术、超薄膜层流延技术和陶瓷粉料、金属电极共烧技术、细微晶粒烧结技术、高致密磁控溅射技术等一系列瓷介电容相关的核心技术，具备完善的技术储备；在环行器及隔离器领域，公司自 2015 年开始研究环行器及隔离器的设计和生产，目前已拥有薄膜铁氧体电路制

备技术、小型化表贴设计技术等一系列环行器及隔离器相关的核心技术，具备完善的技术储备。

截至本募集说明书签署日，公司拥有专利及计算机软件著作权超过 200 项。公司产品研发经验丰富，技术体系完备，因此，本项目的实施具有充分的技术可行性。

(2) 本次募投项目相关产品下游市场空间较大

本次募投项目建设主要用于陶瓷电容器和环行器及隔离器的产能扩张。其中，陶瓷电容器是广泛应用于航天、航空、船舶、武器装备、通信设备、消费电子、汽车电子等众多领域的基本元件，其占整个电容器市场规模的比例超过 50%，远高于其他类别的电容器，市场空间较大；环行器及隔离器广泛应用于基站天线和射频前端，每一代通信技术的革新都将为环行器及隔离器带来大量新增市场需求，5G 基站的建设数量是 4G 基站的 1.2-1.5 倍，此外，5G 基站的天线通道数将由原来的 2-8 通道增加至 64 通道，从而大幅增加环行器及隔离器的市场需求。

因此，本次募投项目相关产品的下游市场空间较大，有利于新增产能的消化，提高项目实施的可行性。

(3) 公司客户认可度较高，营销网络布局完善

一方面，由于公司研发能力突出、产品设计先进且质量稳定，得到了客户的高度认可，曾获得多个大型客户授予的“优秀供应商”奖项，并与下游客户长期合作，形成了重要战略合作伙伴关系，客户群体稳定。

另一方面，公司根据产品的特征和用户的需求等因素，建立较完善的销售网络系统，现已基本实现覆盖全国的销售网络。未来，公司还将进一步推动营销网络的深入布局，将产品研发、设计、生产与销售有机结合，为公司新增产能的消化提供有力支持。

4、项目投资计划

(1) 项目投资构成明细

本项目投资总额为 64,700.00 万元，其中工程建设投入 22,250.00 万元，生产

设备投入 39,450.00 万元，铺底流动资金 3,000.00 万元。本项目拟使用募集资金 62,000.00 万元，不包含董事会前投入的资金，具体投资构成如下表所示：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占比	拟投入募集资金
1	工程建设投入	22,250.00	34.39%	20,250.00
1.1	厂房购置	15,840.00	24.48%	13,840.00
1.2	厂房装修	5,610.00	8.67%	5,610.00
1.3	环保投入	800.00	1.24%	800.00
2	生产设备投入	39,450.00	60.97%	39,450.00
3	铺底流动资金	3,000.00	4.64%	2,300.00
合计		64,700.00	100.00%	62,000.00

(2) 各项投资支出的必要性及测算依据

本项目投资支出的必要性及测算依据如下：

序号	投资项目	必要性	测算依据
1	工程建设投入	-	-
1.1	厂房购置	本项目生产场所购置	厂房购置合同约定金额
1.2	厂房装修	生产场所达到本项目相关产品生产环境要求所需的装修费用	根据当地厂房装修一般价格及厂房面积测算
1.3	环保投入	为满足环保要求，需投入相关废水、废气、固废处理的环保设施	根据相关环保设施建设、环保设备购置所需金额测算
2	生产设备投入	产品生产线建设所需投入的相关机器设备	根据所需机器设备数量及当前价格测算
3	铺底流动资金	项目前期试运行所需的流动资金	根据项目总投资规模，按照一定比例进行谨慎预计

5、项目实施进度

本项目计划建设期为 36 个月，目前公司已完成项目可行性论证、厂区设计与规划等工作。本项目具体实施进度安排如下：

进度阶段（季度）	第一年				第二年				第三年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

进度阶段(季度)	第一年				第二年				第三年			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目可行性论证												
厂区设计与规划												
土地施工及厂房建设												
设备采购及生产线建设												
设备安装调试												
试生产												
批量生产												

6、项目审批及备案情况

本项目于 2021 年 7 月 13 日取得湖南省株洲市天元区发展和改革局颁发的《微波电子元器件生产基地建设项目备案证明》(株天发改备[2021]119 号), 项目编码为 2107-430211-04-01-387138。

本项目于 2021 年 7 月 13 日取得湖南省株洲市生态环境局颁发的《建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批表》(株环天承[2021]7 号)。

7、项目经济效益评价

(1) 本项目经济效益测算假设

- ①国家现行法律、法规无重大变化, 行业政策及监管法规无重大变化;
- ②募投项目主要经营所在地及业务涉及地区的社会、经济环境无重大变化;
- ③行业未来发展趋势及市场情况无重大变化, 行业技术路线不发生重大变动;
- ④募投项目未来能够按预期及时达产;
- ⑤假定在项目计算期内上游原材料供应商不会发生剧烈变动;
- ⑥在项目计算期内下游用户需求变化趋势遵循市场规律。

(2) 本项目经济效益测算过程

①计算期及生产负荷

本项目效益测算计算期为 10 年，其中，项目建设期 3 年，运营期 7 年。本项目建设期第 2 年开始产生收益，建设期第 2 年达产率为 40%，建设期第 3 年达产率为 80%，运营期开始达产率均按 100% 计算。

②收入测算

本项目达产后，新增陶瓷电容器产能 200,000.00 万只/年，新增环形器及隔离器产能 150.00 万只/年，达产后，收入测算如下：

产品名称	应用类别	产能（万只/年）	运营期 平均单价（元/只）	运营期 平均收入（万元）
陶瓷电容器	高可靠	11,000.00	3.13	34,377.04
	民品	189,000.00	0.05	8,956.12
	小计	200,000.00	0.22	43,333.16
环形器及隔离器	高可靠	50.00	108.56	5,427.95
	民品	100.00	18.09	1,809.32
	小计	150.00	48.25	7,237.27
合计				50,570.43

③成本及费用测算

本项目的成本及费用包括生产成本，如直接材料、直接人工、折旧与摊销、其他制造费用等，以及期间费用。

直接材料：公司基于历史期间的原材料采购单价，相关产品的原材料用量等，测算本项目的直接材料成本。

直接人工：公司根据本项目所需的生产人员投入及薪酬水平，测算本项目的直接人工。

折旧与摊销：按照公司现有的折旧与摊销政策，结合本项目的固定资产和无形资产投入，计算折旧与摊销金额。

其他制造费用：根据公司历史期间可能发生的费用进行预测，包括固定资产维修费用、水电能源费用等。

期间费用：根据公司历史期间费用和本项目的具体情况进行预测。

(3) 本项目经济效益测算结果

经测算，本项目达产后的各项经济效益指标如下：

经济效益指标	单位	数量/金额
营业收入	万元/年	50,570.43
利润总额	万元/年	12,121.84
净利润	万元/年	10,303.56
税后内部收益率（IRR）	%	18.71
税后投资回收期（静态，含建设期 36 个月）	年	5.16

注：营业收入、利润总额和净利润为运营期平均数据。

(二) 研发中心建设项目

1、项目基本情况

项目名称：研发中心建设项目

实施主体：成都宏电

项目投资额：20,400.00 万元

项目建设地：成都市双流区军民融合产业园（四川省成都市双流区东升街道永乐村五、六组，九江街道蛟龙社区七组）

项目主要建设内容：（1）研发场地建设及环保设施；（2）购置国内外先进的研发设备，提高研发效率；（3）引入一批高素质的研发人员，增强公司研发实力。

2、项目建设必要性

（1）下游行业技术更迭快，本项目的实施有利于公司适应新技术的发展

公司下游的高可靠领域，以及通信、消费电子、汽车电子和工业装备等行业均为高新技术领域。下游行业的技术快速更迭，使得公司等上游电子元器件和电路模块供应商需不断更新和适应新技术的发展，准确把握市场和客户需求变化，适时布局新产品，不断研发新工艺。

短期来看，本项目的建设有利于增强公司研发和技术实力，提升产品开发和设计能力；长期来看，本项目的实施将引领公司产品及业务的发展方向，使公司更好的适应下游行业的发展趋势，开发出满足市场需求的新产品。

(2) 本项目的实施有利于公司整合研发资源，吸引高端人才

技术创新是企业发展的持续动力，而高端技术人才则是企业技术创新的必要保证。公司所处行业属于技术密集型行业，研发人员需具备多方面的专业知识和技能。本项目的建设，将整合公司现有研发资源，改善研发人员工作环境，打造更为完善的研发平台，有利于吸引更多的高端研发人才。

3、项目建设的可行性

(1) 公司研发体系完善，为本项目实施提供制度保障

公司自成立以来专注于电子元器件和电路模块的研究和开发，建立了完善的研发机制，涵盖了理论研究、多种新型电子元器件和电路模块的开发，为公司保持领先的技术优势提供了保障。公司研发部门下设可靠性研究室、环境试验室、理化分析室、关键材料应用研究室等，拥有完善的研发体系，保证公司产品技术和产品布局适应下游行业技术的不断更迭。公司完善的研发体系是本项目实施的重要保障。

(2) 本项目具备较强的区位优势

本项目的建设地点为成都双流区军民融合产业园。一方面，成都是国内最主要的电子产业聚集区域之一，区域附近拥有丰富的产业资源，以及四川大学、电子科技大学、香港城市大学成都研究院等 30 余个高校院所，有助于公司吸引人才，获得充分的技术支持，从而提升公司人才优势、研发实力；另一方面，成都一直将电子、通信等高新技术产业置于发展的突出位置，不断整合相关行业集群，构建新一代高新技术产业核心体系，从而有利于上游供应商的选择和下游客户的发展。

4、项目投资计划

(1) 项目投资构成明细

本项目投资总额为 20,400.00 万元，其中工程建设投入 11,800.00 万元，研发设备投入 4,600.00 万元，研发人员及其他费用 3,000.00 万元，铺底流动资金 1,000.00 万元。本项目拟使用募集资金 18,000.00 万元，不包含董事会前投入的资金，具体投资构成如下表所示：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额	占比	拟投入募集资金
1	工程建设投入	11,800.00	57.84%	11,800.00
1.1	研发场地建设施工	8,500.00	41.67%	8,500.00
1.2	研发场地装修	3,100.00	15.20%	3,100.00
1.3	环保投入	200.00	0.98%	200.00
2	研发设备投入	4,600.00	22.55%	4,600.00
3	研发人员及其他费用	3,000.00	14.71%	1,600.00
4	铺底流动资金	1,000.00	4.90%	-
合计		20,400.00	100.00%	18,000.00

(2) 各项投资支出的必要性及测算依据

本项目投资支出的必要性及测算依据如下：

序号	投资项目	必要性	测算依据
1	工程建设投入	-	-
1.1	研发场地建设施工	本项目研发场所建设所需的建设施工费用	根据项目用地面积和当地建筑施工一般价格测算
1.2	研发场地装修	研发场所达到本项目相关研发环境要求所需的装修费用	根据当地装修一般价格及研发场所面积测算
1.3	环保投入	为满足环保要求，需投入相关废水、废气、固废处理的环保设施	根据相关环保设施建设、环保设备购置所需金额测算
2	研发设备投入	研发线建设所需投入的相关研发设备	根据所需研发设备数量及当前价格测算
3	研发人员及其他费用	引入高端研发人才、组织进行研发培训等所需费用	根据计划引入的研发人员数量、预计薪酬等进行测算
4	铺底流动资金	项目前期试运行所需的流动资金	根据项目总投资规模，按照一定比例进行谨慎预计

5、项目实施进度

本项目计划建设期为 30 个月，目前公司已完成项目可行性论证和项目选址等工作。本项目具体实施进度安排如下：

进度阶段（季度）	第一年				第二年				第三年	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
项目可行性论证										
研发场地建设及装修										
设备采购及研发线建设										
设备安装调试										
人员招聘及培训										
系统测试及试运营										

6、项目审批及备案情况

本项目于 2021 年 7 月 19 日取得四川省成都市双流区发展和改革局颁发的《四川省固定投资项目备案表》，备案号为川投资备【2107-510122-04-01-562358】FGQB-0349。

本项目于 2021 年 7 月 28 日取得四川省成都市双流生态环境局颁发的《成都双流生态环境局关于成都宏电科技有限公司创新产业研发中心项目环境影响报告表的批复》（成双环承诺环评审[2021]31 号）。

7、项目经济效益评价

本项目的建设目的是为公司开拓新产品、新技术和新工艺，从而实现持续的技术创新，保持市场竞争力。本项目作为非生产型项目，不直接产生效益，但本项目将增强公司技术实力和核心竞争力，对公司未来经营业绩产生巨大的促进作用。

（三）补充流动资金

1、补充流动资金的必要性

公司所在行业和业务特性决定了公司需要大量的流动资金支持。公司作为国

内高可靠电子元器件和电路模块的主要生产企业，在产品销售、原材料采购和产品研发等环节均对流动资金需求较大，具体包括：

(1) 公司下游客户集中度较高，存在一定的回款周期

公司长期服务于多家高可靠领域大型集团，以及通信、消费电子、汽车电子、工业装备等领域的大型终端厂商。经过多年的发展，公司与前述客户建立了长期稳定的业务合作关系，但在业务合作过程中，前述客户一般回款周期较长，部分客户还以商业承兑汇票结算，从而占用公司的流动资金，造成一定资金压力。

(2) 随着公司业务高速发展，对流动资金的需求亦快速提升

近年来，随着高可靠领域，以及通信、消费电子、汽车电子、工业装备等下游行业的需求增加，公司营业收入持续增长，最近三年营业收入复合增长率达48.38%，随着本次微波电子元器件生产基地建设项目和研发中心建设项目两个募集资金投资项目的实施，将进一步提高公司产能和收入规模，对流动资金的需求也将逐步增长。

(3) 资金实力是体现企业竞争力的重要因素之一

公司下游客户主要为大型高可靠集团、通信、消费电子、汽车电子、工业装备等领域的终端厂商，该类客户通常会将供应商的资金实力作为考虑其抗风险能力的重要指标之一，资金实力亦成为公司稳固在行业内市场地位的重要因素之一。公司作为国内知名的高可靠电子元器件和电路模块生产厂商，拥有较强的综合实力，但仍需要通过资本市场拓展融资方式，以应对激烈的市场竞争，因此利用募集资金补充公司流动资金具有必要性。

2、流动资金需求测算

(1) 测算方法

公司采用销售百分比法对未来三年的流动资金需求进行测算。销售百分比法是假设经营性流动资产、经营性流动负债与营业收入之间存在稳定的百分比关系，根据预计销售额与相应百分比预计经营性流动资产、经营性流动负债，然后确定流动资金需求。

(2) 相关假设

选取应收票据、应收账款、预付款项和存货作为经营性流动资产测算指标,应付票据、应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费作为经营性流动负债测算指标。公司主营业务、经营模式和经营效率在未来不发生较大变化的前提下,公司未来各项经营性流动资产、经营性流动负债与销售收入保持较稳定的比例关系。

最近三年,公司营业收入分别为63,631.46万元、84,404.17万元和140,085.76万元,年均复合增长率为48.38%。根据行业发展情况和公司自身经营情况,谨慎预计未来三年营业收入的复合增长率为20%。

(3) 测算结果

根据前述假设,公司未来三年流动资金需求测算过程如下:

单位:万元

项目	2020 年度 /2020 年 12 月 31 日	占营业收入 的比例	2021 年度 /2021 年 12 月 31 日	2022 年度 /2022 年 12 月 31 日	2023 年度 /2023 年 12 月 31 日
营业收入	140,085.76	100.00%	168,102.91	201,723.49	242,068.19
应收票据	76,999.63	54.97%	92,399.56	110,879.47	133,055.36
应收账款	65,881.80	47.03%	79,058.16	94,869.79	113,843.75
预付账款	3,222.41	2.30%	3,866.89	4,640.27	5,568.32
存货	57,318.58	40.92%	68,782.30	82,538.76	99,046.51
经营性流动资金合计	203,422.42	145.21%	244,106.90	292,928.28	351,513.94
应付票据	762.13	0.54%	914.56	1,097.47	1,316.96
应付账款	34,146.22	24.38%	40,975.46	49,170.56	59,004.67
合同负债	3,903.62	2.79%	4,684.34	5,621.21	6,745.46
应付职工薪酬	12,800.51	9.14%	15,360.61	18,432.73	22,119.28
应交税费	3,579.90	2.56%	4,295.88	5,155.06	6,186.07
经营性流动负债合计	55,192.38	39.40%	66,230.86	79,477.03	95,372.43
当年流动资金需求	148,230.04	105.81%	177,876.05	213,451.26	256,141.51
当年新增流动资金需求			29,646.01	35,575.21	42,690.25
累计新增流动资金需求			107,911.47		

如上表所示,预计到2023年度,公司需要补充流动资金107,911.47万元,本次拟利用募集资金补充流动资金20,000.00万元,剩余部分由公司自有资金解决。

提请投资者注意,上述测算过程仅用于理想状况下估算公司业务发展所需的流动资金,不构成公司、保荐机构对公司未来业绩、盈利水平的承诺。

3、本次补充流动资金符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定

本次发行募集资金用于募投项目中的非资本性支出情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	非资本性支出 具体内容	拟投入募 集资金	占本次募集资 金总额的比例
1	微波电子元器件生产基地建设项目	铺底流动资金	2,300.00	2.30%
2	研发中心建设项目	研发人员薪酬 及其他费用	1,600.00	1.60%
3	补充流动资金	补充流动资金	20,000.00	20.00%
合计			23,900.00	23.90%

如上表所示,本次发行募集资金用于非资本性支出的包括“微波电子元器件生产基地建设项目”中的铺底流动资金、“研发中心建设项目”中的研发人员薪酬及其他费用,以及补充流动资金,合计为23,900.00万元,占本次募集资金总额的比例为23.90%,未超过30%,符合《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的规定。

三、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的关系

(一) 本次募投项目与公司既有业务的关系

公司主营业务为高可靠电子元器件和电路模块的研发、生产和销售。本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开,其中,微波电子元器件生产基地建设项目主要用于扩大陶瓷电容器和环行器及隔离器的生产规模,提升产品质量,提高公司在电子元器件领域的市场占有率和市场影响力;研发中心建设项目主要用于提高公司新产品、新工艺的研发能力,依托于成都的区位优势,进一步建设完

善的研发平台；补充流动资金项目可以满足经营规模持续增长带来的资金需求，改善公司财务结构、提高资金实力、降低财务风险。

(二) 本次募投项目与前次募投项目的关系

公司前次募投项目包括“新型低 ESR 有机高分子聚合物电容器生产线建设项目”、“高能钽混合电容器生产线扩展建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”和“其他与主营业务相关的营运资金项目”。

其中，“新型低 ESR 有机高分子聚合物电容器生产线建设项目”和“高能钽混合电容器生产线扩展建设项目”，均为钽电容领域的生产线建设，与本次募投项目相关的陶瓷电容器、环行器及隔离器生产线建设无关。

前次募投项目中的“研发中心建设项目”地点位于株洲市，本次募投项目中的“研发中心建设项目”地点位于成都市，主要系利用成都的区位优势，完善公司的研发体系，吸引高端研发人才，进一步提高公司技术研发实力，同时，两次“研发中心建设项目”涉及的主要研发内容及方向均不同。

四、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金具有必要性和可行性，募集资金投资项目符合国家产业政策及公司战略发展规划。公司投资项目市场潜力较大，募集资金投资项目实施后将给公司带来良好的经济效益，扩大公司业务规模，进一步增强公司经营能力。该项目方案可行，投资风险可控，符合公司和全体股东的利益。

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划

本次发行的募集资金将用于微波电子元器件生产基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。项目实施后将进一步提升公司产能、完善公司产品结构、提升公司研发水平，巩固和加强公司在行业内的地位，为公司未来业务发展提供动力，进一步打造强大的核心竞争力和持续盈利能力。

本次发行募集的资金主要用于推进公司重点项目建设及补充流动资金，本次发行完成后，公司主营业务保持不变，业务收入结构不会发生重大变化。

二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行前，公司的控股股东及实际控制人为曾琛、钟若农和曾继疆，三人的一致行动人，合计直接持有公司286,000,000股股份，持股比例为71.48%。按照发行上限4,001.00万股测算，假设公司控股股东及实际控制人不参与认购，本次发行完成后本公司控股股东及实际控制人合计直接持有公司股份比例为64.98%，仍为本公司的控股股东及实际控制人。

因此，本次发行不会导致本公司控制权发生变化。

三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

截至本募集说明书签署日，公司本次发行尚无确定的对象，因而无法确定本次发行后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。该等情况将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况

截至本募集说明书签署日，公司本次发行尚无确定的对象，因而无法确定本

次发行后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在关联交易情况。该等情况将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

第五节 历次募集资金的使用情况

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲宏达电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1919号）核准，公司于2017年11月10日由主承销商广发证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,010.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币11.16元，募集资金总额为人民币44,751.60万元，募集资金净额为40,466.87万元。上述募集资金已于2017年11月16日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《株洲宏达电子股份有限公司首发验资报告》（众会验字（2017）第9030号）。

二、前次募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司前次募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户均已注销，期末无余额。具体情况如下：

前次募集资金使用情况

单位：万元

募集资金净额：			40,466.87			已累计使用募集资金总额：			38,464.77	
变更用途的募集资金总额：			3,000.00			各年度使用募集资金总额： 2018 年：24,037.50 2019 年：11,112.77 2020 年：3,314.48 2021 年 1-6 月：-				
变更用途的募集资金总额比例：			7.41%							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高能钽混合电容器生产线扩展建设项目	高能钽混合电容器生产线扩展建设项目	12,000.00	9,000.00	7,330.67	12,000.00	9,000.00	7,330.67	-1,669.33 ^{注1}	2019 年 5 月 29 日
2	新型低 ESR 有机高分子聚合物电容器生产线建设项目	新型低 ESR 有机高分子聚合物电容器生产线建设项目	21,000.00	21,000.00	20,766.12	21,000.00	21,000.00	20,766.12	-233.88 ^{注1}	2019 年 5 月 29 日
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	5,000.00	5,000.00	4,745.45	5,000.00	5,000.00	4,745.45	-254.55 ^{注1}	2019 年 10 月 28 日
4	信息化建设项目	信息化建设项目	2,000.00	2,000.00	2,109.66	2,000.00	2,000.00	2,109.66	109.66	2020 年 12 月 31 日
5	-	军民电子创新产业基地项目一期工程	-	3,000.00	3,041.02	-	3,000.00	3,041.02	41.02 ^{注2}	2021 年 5 月 31 日
6	补充营运资金	补充营运资金	466.87	466.87	471.85	466.87	466.87	471.85	4.98	/

注 1：该项目募集资金差额部分主要是公司通过对设备配置及项目环节进行优化，节约了项目投资和各项支出。项目节余资金已用于永久补充流动资金。

注 2：该项目的差额为利息收入，已全部投入建设。

三、前次募集资金使用变更及信息披露情况

变更项目名称	涉及金额	占募集资金总额的比例	变更内容	变更原因	变更程序及批准机构	披露情况
高能钽混合电容器生产线扩展建设项目	投资总额由12,000.00万元调整至9,000.00万元	比例由29.65%调整至22.24%	增加全资子公司作为实施主体并增加实施地点；调整募投项目的建筑工程费及铺底流动资金用于“军民电子创新产业基地项目一期工程”的投资	协调子公司的研发资源，发挥各自优势优化资源配置，提高募集资金的使用效率和投资回报，拓展公司主营业务，提升公司竞争力	2018年7月3日公司第一届董事会第二十次会议、公司第一届监事会第十一次会议、公司2018年第四次临时股东大会	巨潮资讯网 公告编号（2018-045） 公告编号（2018-047） 公告编号（2018-051）
新型低ESR有机高分子聚合物电容器生产线建设项目	21,000.00万元	51.89%	增加全资子公司作为实施主体；调整募投项目的建筑工程费、设备购置及安装费	协调子公司的研发资源，发挥各自优势优化资源配置，提高募集资金的使用效率和投资回报，拓展公司主营业务，提升公司竞争力	2018年7月3日公司第一届董事会第二十次会议、公司第一届监事会第十一次会议、公司2018年第四次临时股东大会	巨潮资讯网 公告编号（2018-045） 公告编号（2018-047） 公告编号（2018-051）
军民电子创新产业基地项目一期工程	3,000.00万元	7.41%	将高能钽混合电容器生产线扩展建设项目工程费用投入中的建筑工程费2,226.84万元调减，同时调减部分铺底流动资金773.16万元，合计调减3,000.00万元将投入“军民	提高募集资金的使用效率和投资回报，拓展公司主营业务，提升公司竞争力	2018年7月3日公司第一届董事会第二十次会议、公司第一届监事会第十一次会议、公司2018年第四次临时股东大会	巨潮资讯网 公告编号（2018-045） 公告编号（2018-047） 公告编号（2018-051）

变更项目 名称	涉及金额	占募集资金总 额的比例	变更内容	变更原因	变更程序及批准机构	披露情况
			电子创新产业基地项目一期工程”			
信息化建 设项目	2,000.00 万元	4.94%	将达到预定可使用状态日期调整为 2020 年 5 月 31 日	随着公司发展,原有的 ERP 系统无法满足日益增长的业务需求,需要结合公司未来规划和战略布局重新挑选涉及公司各个业务层面的 ERP 供应商,前期选型及实施周期长	2019 年 5 月 29 日公司第二届董事会第七次会议、公司第二届监事会第五次会议	巨潮资讯网 公告编号（2019-038） 公告编号（2019-039） 公告编号（2019-041）
信息化建 设项目	2,000.00 万元	4.94%	将达到预定可使用状态日期调整为 2021 年 5 月 31 日	因受疫情影响,项目组相关人员未能及时复工,导致项目进度延迟	2020 年 4 月 27 日,公司第二届董事会第十四次会议、公司第二届监事会第十一次会议	巨潮资讯网 公告编号（2020-031） 公告编号（2020-032） 公告编号（2020-037）

四、前次募集资金投资项目效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	实际效益				截至 2021 年 6 月 30 日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度		
1	新型低 ESR 有机高分子聚合物电容器生产线建设项目	81.89%	16,907.83	5,376.25	8,586.84	1,886.84	-	15,849.93	注 1
2	高能钽混合电容器生产线扩展建设项目	124.36%	8,428.35	16,439.47	29,131.73	6,714.17	-	52,285.37	是
3	研发中心建设项目		-	不适用				-	注 2
4	信息化建设项目		-	不适用				-	
5	军民电子创新产业基地项目一期工程		-	不适用				-	
6	补充营运资金		-	不适用				-	\

注 1：该项目的承诺效益按照达产期后全部用于生产和销售高可靠产品进行测算，但由于高可靠单位对新产品导入较为谨慎，验证周期较长，尚处于需求爬坡期，故导致承诺效益的实现期晚于预测；同时，除高可靠产品外，该项目亦可用于单价相对较低的民品生产，公司结合自身战略发展规划，在高可靠产品的需求爬坡期，积极拓展民品市场，充分利用现有产能，以实现股东利益最大化。

注 2：该三类项目效益主要体现为提升研发实力、节约成本、提高办公效率，不直接产生经济效益。

五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2018年2月12日,公司召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额 3,972.88 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了《株洲宏达电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众会字(2018)第 9001 号);独立董事出具了《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》;广发证券股份有限公司出具了《关于株洲宏达电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。2017 年度,公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额 3,972.88 万元于 2018 年 3 月 16 日全部完成置换。

六、前次募集资金结余及募集资金后续使用情况

2019 年 5 月 29 日,公司召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首发募集资金项目“高能钽混合电容器生产线扩展建设项目”、“新型低 ESR 有机高分子聚合物电容器生产线建设项目”和“补充营运资金”项目结项,并将上述项目的结余募集资金(含利息收入)合计 3,039.29 万元永久补充公司流动资金,同时注销对应的募集资金专户。公司及湖南湘怡中元科技有限公司与广发证券股份有限公司、株洲县融兴村镇银行、中国光大银行株洲文化路支行共同签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》随之终止。

2019 年 10 月 28 日,公司召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首发募集资金项目“研发中心建设项目”结项,并将上述项目的结余募集资金(含利息收入)合计 387.51 万元永久补充公司流动资金,同时注销对应的募集资金专户。公司与广发证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司株洲分行签订了《募集资金三方监管协议》随之终止。

2020 年 12 月 16 日，公司“军民电子创新产业基地项目一期工程”募集资金投资完毕，结余募集资金 1.34 万元；2020 年 12 月 31 日，公司“信息化建设项目”结项，结余募集资金 28.41 万元。由于上述两个项目结余募集资金低于 500 万元且低于项目募集资金净额的 5%，根据相关规定无需提交董事会审议，将结余资金永久补充公司流动资金。结余募集资金划转完成后，同时注销对应的募集资金专户。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户均已注销，期末无余额。

第六节 与本次发行相关的风险因素

一、本次向特定对象发行 A 股股票的相关风险

(一) 审批风险

本次发行方案已经 2021 年 6 月 4 日召开的公司第二届董事会第二十次会议及 2021 年 6 月 23 日召开的公司 2021 年度第一次临时股东大会决议审议通过，并已通过深交所审核，尚待中国证监会同意注册后方可实施，该等审批事项的结果以及所需的时间均存在不确定性。

(二) 发行风险

由于本次发行为向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集资金，且发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次发行存在发行募集资金不足的风险。

(三) 本次发行股票摊薄即期回报的风险

由于本次发行募集资金到位后公司的总股本和净资产规模将会大幅增加，而募投项目效益的产生需要一定时间周期，在募投项目产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要通过现有业务实现。因此，本次发行可能会导致公司的即期回报在短期内有所摊薄。

此外，若公司本次发行募集资金投资项目未能实现预期效益，进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能产生相应增长，则公司的每股收益、净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次发行股票可能摊薄即期回报的风险。

二、行业及市场风险

(一) 宏观环境变化的风险

公司致力于电子元器件及电路模块的研发、生产和销售，主营业务包括高可靠产品和民用产品两大类，以提供高可靠电子元器件及解决方案为主。高可靠产

品领域作为特殊的经济领域，主要受国际环境、国际安全形势、地缘政治以及国防发展水平等多种因素影响。若未来国际形势或国家安全环境出现重大变化，则可能对公司生产经营产生不利影响。

(二) 行业管理体制变化的风险

企业从事高可靠业务需要取得相关业务资质，并具备高程度的技术壁垒，且基于稳定性、可靠性、保障性等考虑，高可靠产品一般均由原研制、定型厂家保障后续生产供应。但在国家持续鼓励高可靠行业发展的情况下，越来越多的民营企业参与到高可靠行业的发展中来。同时，政府对于民营高可靠企业，在具体管理制度上更为市场化，更加灵活。若行业管理体制、市场进入条件等发生变化，可能会吸引新的竞争对手进入，导致公司所在行业竞争加剧，将对公司生产经营环境产生重大影响。

(三) 下游市场需求变动的风险

公司的产品涵盖钽电容器、陶瓷电容器、其他电子元器件及电路模块等，主要产品广泛应用于飞行器、车辆、船舶、雷达、电子对抗等高可靠领域和智能手机、工业控制设备、医疗设备、充电桩、笔记本电脑、仪器仪表、汽车电子等民用领域。若未来相关行业预算或行业整体增长不及预期，或产品技术水平、居民收入水平、消费者偏好等方面发生重大变化，使得下游行业需求增长减缓甚至负增长，公司将面临相关产品市场需求不足的风险。

三、业务经营风险

(一) 新产品研发失败或进度不及预期的风险

公司产品的研发需经过立项、方案论证、工程研制、定型等阶段。从研制到实现销售的周期长，研发投入高。作为电子元器件及电路模块供应商，公司研发的产品通过客户鉴定定型后，标志公司产品达到客户量产需求，可以批量向客户供货。如果公司新产品未能通过鉴定定型，或研发的产品所应用的整机未能通过鉴定定型，导致相关产品将无法向客户销售，可能对公司财务状况及经营业绩将造成不利影响，前期投入的研发费用也可能无法收回。

(二) 高可靠产品采购特点导致公司经营业绩的波动性风险

由于我国高可靠电子行业近年来发展快速,下游客户每年对公司产品的采购量稳步上升,公司营业收入逐年增长,报告期内,公司营业收入分别为63,631.46万元、84,404.17万元、140,085.76万元和92,269.95万元。报告期内,公司的经营业绩未出现明显的波动,但不排除未来因高可靠领域客户根据相关政策需要间歇性提高或降低采购量,而导致公司年度经营业绩出现波动。

(三) 公司规模迅速扩张导致的管理风险

随着公司快速发展,公司销售收入快速增长,业务规模不断扩张,涉及业务领域不断增加,在产品研发、资源整合、质量管理、财务管理和内部控制等方面对公司提出更高的要求。虽然公司目前已积累了丰富的管理经验,完善了公司治理结构,形成了有效的内部激励和约束机制,但如果公司管理水平不能在经营规模扩大的同时适时调整和优化管理体系、完善内部控制制度、提升经营管理水平,适应业务、资产及人员规模迅速扩张的需要,将对公司竞争力的持续提高、未来研发及生产的组织管理产生不利影响。

(四) 人才流失风险

公司所处行业属于人才密集型行业,拥有高水平的研发人员是公司核心竞争力之一。虽然公司目前拥有一批技术专业丰富、研发能力突出的核心技术人员,但如果公司不能建立良好的企业文化、完善的职业发展通道、科学的激励机制,将导致公司无法进一步吸引到所需的高端人才,甚至导致公司核心骨干人才流失,将对公司经营发展造成不利的影响。

(五) 资质风险

对于高可靠产品市场,由于产品应用环境条件的特殊性 & 高可靠性的要求,进入该市场需通过系统性的严格考核,取得相关的资质认证。上述资质的取得需从科研生产能力、质量管理水平、产品质量保障、保密体系管理等多方面进行逐项审核与考评,需要周期较长,且持续进行动态管理。虽然公司一直从事高可靠产品业务,具有丰富的行业经验,生产研发一直遵循相关国家标准,但随着政策变化,仍存在公司未来资质变化的可能性,相关资质的变化可能影响公司的经营活动,进而影响公司的经营业绩。

(六) 国家秘密泄露的风险

承担高可靠产品科研生产任务的公司均须经过保密资格审查认证。公司已取得相关保密资格证书,在生产经营中一直将安全保密工作放在首位,采取各项有效措施保守国家秘密,但不排除意外情况发生,导致有关国家秘密泄露,进而可能对公司生产经营产生不利影响。

(七) 产品质量风险

如果未来公司在产品持续升级迭代、新产品开发过程中不能达到客户质量标准,甚至出现重大的产品质量问题,将可能导致产品暂停供应、客户合作关系停止、公司形象受损等多种不利情形,从而对公司的生产经营产生不利影响。

四、税收及财务风险

(一) 应收账款及应收票据回收风险

报告期各期末,公司的应收账款分别为 40,200.00 万元、52,048.17 万元、65,881.80 万元和 104,537.80 万元,占总资产的比例分别为 23.94%、26.37%、22.24%和 30.74%,应收账款坏账准备计提比例分别为 7.79%、7.56%、6.87%、5.33%。公司的应收票据分别为 37,936.74 万元、46,520.62 万元、76,999.63 万元和 53,949.61 万元,占总资产的比例分别为 22.59%、23.57%、25.99%和 15.86%,应收票据坏账准备计提比例在报告期各期均为 4.00%。报告期内,随着公司营业收入的不断增长,应收账款和应收票据规模也不断增长,主要系公司主要客户为大型高可靠集团下属单位,付款周期相对较长所致,大额应收账款和应收票据影响公司资金回笼速度,给公司带来的资金压力不断提升。如果国际形势、国家安全环境发生变化,导致公司主要客户经营发生困难,进而不能按期付款,将会导致公司出现应收账款及应收票据无法收回的风险。

(二) 商业承兑汇票无法兑付风险

报告期各期末,公司的商业承兑汇票账面余额分别为 35,611.13 万元、43,491.47 万元、73,570.49 万元和 55,971.95 万元,商业承兑汇票坏账准备计提金额分别为 1,424.45 万元、1,739.66 万元、2,942.82 万元、2,238.88 万元,计提比例均为 4%。发行人商业承兑汇票主要来自于大型高可靠集团,如果客户经营发

生困难，则可能出现商业承兑汇票无法兑付的风险。

（三）存货规模增长及存货减值的风险

报告期内，公司业务规模持续增长，导致存货增长较快。公司的存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品组成。报告期各期末，公司的存货账面价值分别为26,048.82万元、34,815.63万元、57,318.58万元和74,214.46万元，占流动资产比例分别为18.40%、20.71%、24.60%和27.94%。公司存货规模较大，一定程度上占用了公司资金而影响流动性。较高的存货规模仍可能导致计提较大金额的存货跌价准备，进而影响公司的利润水平。报告期各期末，公司分别计提存货跌价准备2,243.61万元、3,475.38万元、4,266.28万元及4,951.05万元。库存量能够保障生产经营的稳定性，但如果原材料、库存商品的行情出现大幅下滑或者公司产品销售不畅、发出商品未能得客户及时验收，而公司未能及时有效应对并做出相应调整，公司将面临存货减值的风险，进而会给公司经营造成一定的不利影响。

（四）毛利率波动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率和综合毛利率整体相对较高且呈增长态势，主要受行业景气度较高、下游客户需求不断增加、行业技术和资质壁垒较高、高可靠产品定价具备较大优势、公司竞争力较强以及有效的成本控制严格等多方面因素影响。如果未来出现行业政策变化、下游需求缩紧、市场竞争进一步加剧、原材料价格大幅上涨单方向波动、人工成本大幅增长上升等不利因素，发行人主营业务毛利率和综合毛利率水平可能会出现下滑的风险。

（五）税收优惠政策变动风险

报告期内，公司及子公司湖南冠陶、湘怡中元、宏达磁电、成都华镭、湖南宏微、宏达膜电、华毅微波、深圳波而特作为高新技术企业，根据国家相关政策规定，按15%的税率征收企业所得税。国家一直重视对高可靠行业、高新技术行业的政策支持，鼓励自主创新，公司享受的各项税收政策优惠有望保持延续和稳定，但如果未来国家税收政策变化或公司不再符合高新技术认定标准等原因，公司所得税税率将发生变化，将对公司经营业绩产生一定的影响。

五、募投项目相关风险

(一) 募投项目实施进度风险

截至本募集说明书签署日,发行人“微波电子元器件生产基地建设项目”的建设地尚未办理不动产权证过户并取得相关产权证书。如果发行人一直未能取得产权证书,可能对募投项目实施的整体进度造成一定影响。此外,随着公司相关产品产能的扩张,公司的资产规模及业务复杂度将进一步提升,研发、运营和管理人员将相应增加,如果公司未能根据业务发展状况及时提升人力资源、法律、财务等方面的管理能力,可能会影响项目研发及建设进程,导致项目未能按期投入运营的风险。

(二) 募投项目收益未达预期风险

本次募集资金拟用于的项目包括微波电子元器件生产基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。虽然公司对本次募集资金投资项目均进行了审慎的可行性论证和充分的市场调查,但在募投项目的实施过程中,公司面临行业发展变化、市场竞争变化、高可靠单位验证周期变化等多重不确定性,可能对实现预期收益的前提条件产生不利影响。此外,如本次募投项目的成本费用无法有效控制,或者公司未能按既定计划完成募投项目,可能会影响募投项目的投资成本、投资回收期、投资收益率等,从而可能导致募集资金投资项目的实际效益与预期存在一定的差异。

(三) 募投项目新增产能消化的风险

本次募投项目中,微波电子元器件生产基地建设项目将新增陶瓷电容器产能200,000万只/年,新增环行器及隔离器产能150万只/年,新增产能均可用于高可靠产品和民用产品。在高可靠领域,发行人已与众多高可靠领域集团签订正式协议;在民用领域,发行人现有或潜在客户的需求量较大,但受限于产能不足,尚无法满足相关民用客户的大批量需求,因而尚未签署正式业务协议。通过本次募投项目的实施将有利于缓解现有产能瓶颈,提高产品质量,丰富产品结构,保障企业持续高水平发展。但上述募投项目的必要性和可行性分析是基于当前宏观经济环境、产业发展趋势、市场整体供求关系及公司未来发展战略等因素作出的判断。未来募投项目建设完成并投入实施后,如果行业政策、市场需求和技术发展等方面发生不利变化,将对公司实施募投项目产生不利影响,且如果未来民用产

品市场拓展不及预期,可能导致募集资金投资项目投产后新增产能无法及时消化,从而对公司经营业绩产生不利影响。

(四) 募投项目新增固定资产折旧和摊销的风险

发行人按照当前执行的折旧与摊销政策,对本次募投项目新增固定资产进行折旧和摊销。微波电子元器件生产基地建设项目预计建成后的年均折旧和摊销金额为7,925.89万元,研发中心建设项目预计建成后的年均折旧和摊销金额为1,829.16万元,合计占公司最近三年平均营业收入的10.16%,可能存在因资产折旧增加导致公司经营业绩受到不利影响的风险。

(五) 募投项目研发失败的风险

公司下游的高可靠领域,以及通信、消费电子、汽车电子和工业装备等行业均为高新技术领域。下游行业的技术快速更迭,使得公司等上游电子元器件和电路模块供应商需不断更新和适应新技术的发展,准确把握市场和客户需求变化,适时布局新产品,不断研发新工艺。本次募投项目之研发中心建设项目实施后,公司每年研发投入支出将存在一定幅度的提升,将对当期业绩产生影响。

此外,本次募投项目建设的超宽带嵌入式板卡相关产品技术壁垒相对较高、研发难度较大,需要一定的技术和研发人才储备。如果公司出现人才流失,或者无法突破研发难点的情形,则可能导致研发失败,将会对公司的经营情况产生一定的不利影响。

六、股价波动风险

股票市场投资收益与风险并存。股票的价格不仅受公司盈利水平和公司未来发展前景的影响,还受投资者心理、股票供求关系、公司所处行业的发展与整合、国家宏观经济状况以及政治、经济、金融政策等诸多因素的影响。同时,公司本次发行尚需履行多项审批程序,需要一定的时间周期方能完成,在此期间,公司股票的市场价格可能会出现波动,直接或间接对投资者造成损失,投资者在考虑投资本公司股票时,应预计前述因素可能带来的投资风险,并做出审慎的判断。

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：



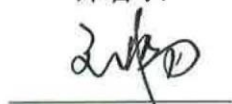
钟若农



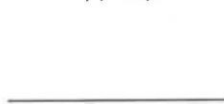
曾琛



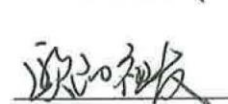
毛云武



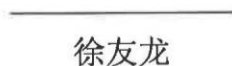
刘畅



高成

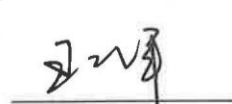


欧阳祖友

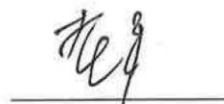


徐友龙

全体监事签名：



王大辉



樊平



陈雪梅

非董事高级管理人员签名：



钟少卿



曾垒

株洲宏达电子股份有限公司



2024年9月29日

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

钟若农

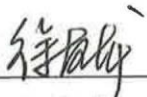
曾琛

毛云武

刘畅

高成

欧阳祖友


徐友龙

全体监事签名：

王大辉

樊平

陈雪梅

非董事高级管理人员签名：

钟少卿

曾垒



一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

_____ 钟若农	_____ 曾 琛	_____ 毛云武
_____ 刘 畅	 高 成	_____ 欧阳祖友
_____ 徐友龙		

全体监事签名：

_____ 王大辉	_____ 樊 平	_____ 陈雪梅
--------------	--------------	--------------

非董事高级管理人员签名：

_____ 钟少卿	_____ 曾 垒
--------------	--------------



二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人签名：


钟若农


曾 琛

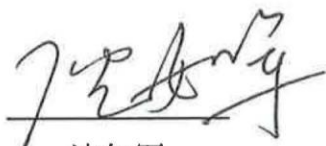

曾继疆



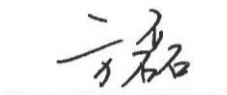
三、保荐人（主承销商）声明

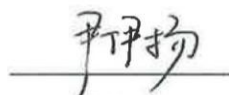
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

法定代表人、董事长：


沈如军

保荐代表人：


方 磊


尹伊扬

项目协办人：


吴占宇



中国国际金融股份有限公司

2021 年 9 月 29 日

保荐机构董事长声明

本人已认真阅读株洲宏达电子股份有限公司关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的募集说明书的全部内容,确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

法定代表人、董事长签名:



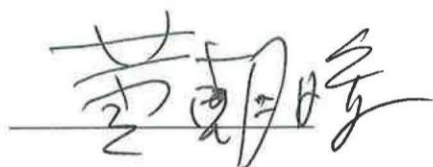
沈如军



保荐机构首席执行官声明

本人已认真阅读株洲宏达电子股份有限公司关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的募集说明书的全部内容, 确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

首席执行官签名:



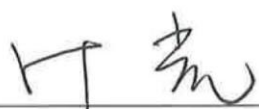
黄朝晖



律师声明

本所及经办律师已阅读《株洲宏达电子股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，确认募集说明书的内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师：


叶 凯


蔡 丽

北京金杜（成都）律师事务所

北京金杜（成都）律师事务所单位负责人：

北京市金杜律师事务所

北京市金杜律师事务所单位负责人：


卢 勇


王 玲

2021 年 9 月 29 日

五、发行人会计师声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书,确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

签字注册会计师:

文爱凤

文爱凤



陆尧钦

陆尧钦



会计师事务所负责人:

陆士敏

陆士敏



众华会计师事务所(特殊普通合伙)



2021 年 9 月 29 日

六、发行人董事会声明

1、除本次发行外，公司在未来十二个月内暂无其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况安排股权融资，将按照相关法律法规履行审议程序和信息披露义务。

2、为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险。公司填补即期回报的具体措施如下：

(1) 加强募集资金的管理和运用，加快募投项目投资进度

本次发行募集资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市规则》以及《株洲宏达电子股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的有关规定，加强募集资金使用的管理，公司董事会将持续监督对募集资金进行专户存储、保障募集资金按顺序用于规定的用途、配合保荐机构等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

(2) 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。

(3) 进一步加强经营管理及内部控制，提升公司运营效率

公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合

理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。

(4) 进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司持续重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，持续修改和完善《公司章程》并相应制定股东回报规划。公司的利润分配政策重视对投资者尤其是中小投资者的合理投资回报，将充分听取投资者和独立董事的意见，切实维护公司股东依法享有投资收益的权利，体现公司积极回报股东的长期发展理念。

未来公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，在本次发行完成后，公司将严格执行分红政策。

3、相关主体关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺。

(1) 公司控股股东及实际控制人的承诺

公司控股股东、实际控制人曾琛、钟若农和曾继疆根据中国证监会相关规定，对公司采取的填补措施能够得到切实履行，作出如下承诺：

①不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施；

②自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；

③如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

(2) 董事、高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并为贯彻执行中国证监会相关规定和文件精神，就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实地履行，作出如下承诺：

①本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

②本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

③本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

④本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

⑤本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

⑥如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

⑦本人承诺，自本承诺出具日至公司本次发行股份实施完毕，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构规定的，本人承诺将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定作出承诺。

⑧作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关措施。本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

(此页无正文,为《株洲宏达电子股份有限公司关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的募集说明书》之董事会声明盖章页)

株洲宏达电子股份有限公司董事会



2021 年 9 月 29 日